

接着・封止材

Weekly Intelligence Report

2026-06-20 | 21件 | 9カ国

troy-technical.jp

今週のキーワード

AI半導体材料

日本勢が技術・供給で優位性を確立

21

件
記事数

9

カ国
対象国

2030年

まで
ABF供給確保

1.5-4kg

/100kWh
EV電池TIM

今週的全21記事 — 5軸評価で読むべき記事を選ぶ

各列の見方 — 技術新規性：ブレイクスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#01	レゾナックAI封止材	企業発表	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	レゾナックの生成AI向け2.5D半導体パッケージ用液状封止材特許が有効維持され、高密度パッケージの信頼性課題解決に貢献。
#02	味の素ABF供給	企業戦略	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	味の素がAIチップ需要急増に対応し、半導体材料ABFの供給能力を2030年まで確保する計画を発表。価格は据え置き。
#03	ヘンケル工場CN達成	企業活動	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	ヘンケル南アフリカのアルロード工場が太陽光発電導入でカーボンニュートラルを達成。稼働電力の65%を賄う。
#04	TPOフリーUV接着剤	新製品	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	EU規制強化に対応し、Delo、DymaxなどがTPO・IBOAフリーのUV硬化型接着剤を発表。医療・構造用途に革新。
#05	サグラダ・ファミリア	製品応用	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	ヘンケルがサグラダ・ファミリア中央塔のモジュール式建設にLoctite EA 9497構造用接着剤を提供、工期短縮と耐久性確保に貢献。
#06	BASF固体電池バインダー	新製品	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	BASFが次世代EV固体電池向け高性能PIBバインダー「Oppanol® N PLUS」を発表。バッテリー寿命と安定性向上に寄与。
#07	Sihl偽造防止ラベル	新製品	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	Sihlが偽造防止を強化するデュアル機能セキュリティラベル材料を新発売。顕在的・潜在的セキュリティ要素を統合。
#08	ヘンケル持続可能PKG	製品紹介	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	ヘンケルがInterpack 2026で低CO ₂ ホットメルトや溶剤フリー積層接着剤など、持続可能なパッケージングソリューションを展示。
#09	AI半導体PKG動向	業界レポート	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	AI駆動の光学-ロジック統合加速とハイブリッドボンディングによる接続密度向上を強調する半導体工学レポート。
#10	自動車軽量化接着剤	解説記事	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	EVバッテリーパックや多素材BIWにおける接着剤の役割が自動車軽量化の鍵。衝突安全性、NVH改善に貢献。
#11	Bostik衛生接着剤	新製品	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	Bostikのリサイクル可能な衛生接着剤「Kizen® Miles 9.0」が受賞。75%再生可能材料を使用し、リサイクル性を向上。
#12	米TIM市場成長	市場レポート	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	米国の熱界面材料（TIM）市場が2033年までにEVバッテリーパックの熱ギャップフィラー需要で大幅成長と予測。

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#13	レゾナック特許維持	報道	●●●●○	●●●●● ●	●●●●● ●	●●●●○	●●●●● ●	レゾナックの生成AI向け2.5D半導体液状封止材の特許有効性が日本特許庁によって維持。信頼性向上に貢献。
#14	3M VHBテープ	製品紹介	●●●●○	●●●●● ●	●●●●● ○	●●●●○	●●●●○	3M VHB 4920アクリルフォームテープがAIサーバーやEV向けに高強度接合ソリューションを提案。振動吸収性も優れる。
#15	レゾナックCEO戦略	企業戦略	●●●●○	●●●●● ●	●●●●● ●	●●●●○	●●●●● ●	レゾナックCEOがAIチップ需要急増と中国サプライチェーンリスクを両立させる戦略を強調。特許維持で技術優位性強化。
#16	H.B. Fuller目標	企業戦略	●●●●○	●●●●● ○	●●●●○	●●●●● ○	●●●●○	H.B. Fullerが2030年までの持続可能性目標を発表。新製品開発の60%を持続可能ソリューションに集中。
#17	AMS買収交渉延長	M&A;動向	●●●●○	●●●●● ○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	Advanced Medical SolutionsがH.B. Fullerからの買収提案交渉期限を2026年7月2日まで延長。
#18	3M新顕微鏡導入	企業活動	●●●●● ○	●●●●● ●	●●●●● ○	●●●●● ○	●●●●○	3Mが原子レベルの材料解析を可能にする新走査型透過電子顕微鏡を導入し、製品開発を加速。
#19	味の素ABF価格戦略	企業戦略	●●●●○	●●●●● ●	●●●●● ●	●●●●○	●●●●● ●	味の素がAI需要急増下のABF価格据え置き戦略を継続。投資家はポートフォリオ再構築を迫られる可能性。
#20	味の素ABF供給逼迫	市場危機	●●●●○	●●●●● ●	●●●●● ●	●●●●○	●●●●● ●	AI需要拡大で味の素ABFが供給逼迫の試練に直面。価格戦略が半導体業界の焦点に。
#21	PU接着剤市場拡大	市場レポート	●●●●○	●●●●● ●	●●●●● ○	●●●●○	●●●●● ●	PU接着剤市場が自動車エレクトロニクス小型化と熱管理の進化で拡大。3M、Henkel、Dowが主導。

●●●●○ High ●●●●○ Med-High ●●●●○ Med ●●●●○ Low | 背景黄色 = 注目記事

今週、判断に影響する3つの問い

① AI半導体材料の安定供給、自社は確保できているか？

レゾナックの液状封止材特許維持や味の素のABF供給戦略は、AI半導体市場における日本企業の優位性を示唆します。しかし、味の素ABFの供給逼迫懸念も浮上しており、自社のサプライチェーンにおけるAI関連材料の安定供給体制を再確認する必要があります。

② 次世代パッケージング技術への対応、R&D;は追いついているか？

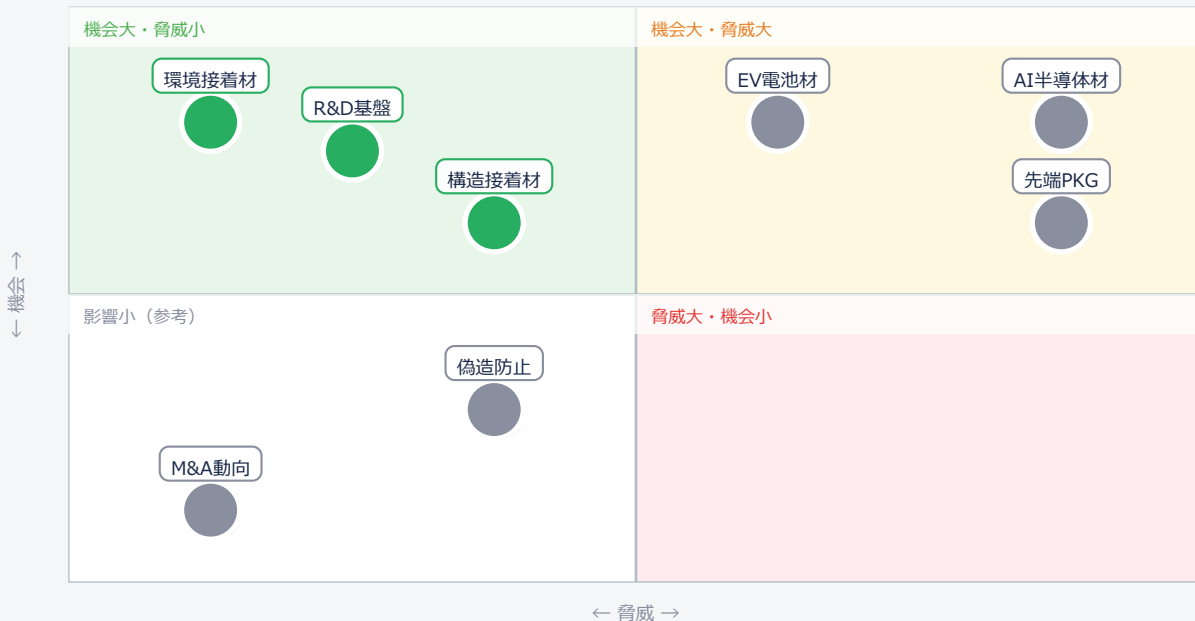
AI駆動の光学-ロジック統合やハイブリッドボンディングといった先端パッケージング技術は、半導体産業の設計思想を根本から変えつつあります。3Mが原子レベル解析技術を導入するなど、材料開発のスピードも加速。自社のR&D;部門は、これらの技術変化に迅速に対応できる体制を構築できているのでしょうか？

③ 環境規制強化とサステナブル材料への転換、ビジネスチャンスをつかえているか？

EUのTPO・IBOAフリー規制やBostikのリサイクル可能接着剤、ヘンケルの低CO₂製品など、環境配慮型材料へのシフトが加速しています。これは単なるコスト増ではなく、新たな市場機会を創出する可能性を秘めています。自社の製品ポートフォリオや開発計画は、この大きな潮流をビジネスチャンスとして捉えられているのでしょうか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス



項目	象限	↑ 機会	↓ 脅威
● AI半導体材	注意	日本勢の技術優位性	供給逼迫と価格競争
● EV電池材	注意	次世代電池材の需要増	競争激化と技術変化
● 先端PKG	注意	新技術への参入	技術変化への対応
● 環境接着材	機会大	環境規制対応製品	規制強化への遅れ
● 構造接着材	機会大	新市場・用途開拓	既存工法との競合
● R&D;基盤	機会大	開発効率向上	投資不足による遅れ
● M&A;動向	参考	事業拡大の機会	競合再編

● 偽造防止	参考	ブランド保護	—
--------	----	--------	---

深掘り ① — AI駆動の先端半導体PKG技術動向

#09 | 2026/06/18 | Semiconductor Engineering | 技術新規性●●●●● 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●●

Semiconductor Engineeringのレポートは、AIシステムが光学部品とロジックチップの統合を加速させていると指摘。製造、パッケージング、熱管理、材料、テスト技術の共進化が不可欠であり、特にハイブリッドボンディング技術が前例のない接続密度を実現しています。

Intel FoundryのLori Scott氏がECTC 2026でEMIB-T、コパッケージドオプティクス、ガラスパッケージングの進展に言及。これらはAI、高性能コンピューティング、5G通信、自動運転といったメガトレンドを支える次世代技術の核となります。

▶ 技術者の視点

このレポートは、半導体パッケージングの未来像を明確に示しています。光学-ロジック統合やハイブリッドボンディングは、従来の接着・封止材の概念を大きく変える可能性があり、材料メーカーは単なる接着だけでなく、信号伝送や熱管理といった複合機能を持つ材料開発が必須となります。提示された技術はまだ応用研究段階が多く、実用化には材料特性のさらなる最適化や量産プロセスの確立が課題です。日本企業にとっては、高精度な材料技術と製造装置技術を活かし、この新領域でリーダーシップを確立する【機会】がある一方、技術変化への対応が遅れば、サプライチェーンから取り残される【脅威】となります。特にガラスパッケージングは、日本のガラスメーカーにとって大きなチャンスです。

深掘り ② — レゾナック、AI向け2.5D封止材特許維持

#01 | 2026/06/17 | Resonac | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●● データ信頼性●●●●○
日本関連度●●●●●

レゾナックは、生成AI向け2.5D半導体パッケージ用液状封止材に関する日本特許（特許番号7687499）の有効性が維持されたと発表しました。この技術は、半導体パッケージにおける熱膨張差による応力やクラック発生といった信頼性課題を解決するものです。

同社は、特定の熱膨張係数と弾性率の範囲内で樹脂と添加剤を最適化することで高信頼性を実現。AI半導体市場におけるレゾナックの技術的優位性を確固たるものとし、高密度パッケージング技術の発展に貢献することが期待されます。

▶ 技術者の視点

レゾナックの特許維持は、AI半導体市場における日本の材料技術の強さを改めて示すものです。2.5D/3Dパッケージングでは、異なる材料間の熱膨張差に起因する応力緩和が極めて重要であり、この液状封止材はまさにその核心を突いています。具体的な数値データは示されていませんが、特許庁が有効性を認めたことは技術的妥当性の証左と言えるでしょう。実用化は既に進んでおり、今後のAI半導体の高性能化・高信頼性化に不可欠な材料となるでしょう。日本企業にとっては、この分野での技術的リーダーシップをさらに強化する【機会】である一方、競合他社が同様の技術を開発してくる【脅威】も存在します。継続的なR&D;投資と特許戦略の強化が求められます。

深掘り ③ — BASF、EV固体電池向けPIBバインダー

#06 | 2026/06/16 | SpecialChem | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●○○

BASFは、Battery

Show

Europe

2026で次世代EV固体電池向け高性能ポリイソブテン（PIB）バインダー「Oppanol®

N

PLUS」を発表しました。高い弾性と一貫した品質を特徴とし、バッテリーの寿命と安定性に貢献します。

このバインダーは、固体電池の充放電サイクル中に発生する電極材料の膨張・収縮による機械的ストレスを吸収・補償することで、界面剥離やクラック形成を防ぎます。固体電池の実用化における主要課題の一つを解決し、EVの航続距離と安全性を向上させる可能性を秘めています。

▶ 技術者の視点

固体電池の実用化に向けたバインダー技術の進展は非常に重要です。特に、電極と固体電解質の界面安定性は、固体電池の性能と寿命を左右する最大の課題の一つ。PIBバインダーの高い弾性は、この課題に対する有望なアプローチです。ただし、固体電池はまだ応用研究段階であり、このバインダーが実際にどの程度のサイクル寿命やエネルギー密度向上に寄与するのか、具体的な定量データが待たれます。日本企業、特に電池材料メーカーや自動車OEMにとっては、この種の高性能バインダーを早期に評価し、自社の固体電池開発ロードマップに組み込む【機会】となります。一方で、海外勢が先行する材料技術に追従できない場合、次世代電池開発で遅れをとる【脅威】にもなり得ます。

その他の注目記事

味の素、AI需要急増に対応し半導体材料「ABF」供給能力を2030年まで確保へ — 価格据え置きで増産計画 (GIGAZINE)

技術新規性●●○○○ 市場インパクト●●●●● 日本関連度●●●●●

AI半導体市場を支える基幹材料ABFの安定供給は極めて重要。日本企業の長期的な供給コミットメントは評価される。

3M、原子レベルの材料解析を可能にする新走査型透過電子顕微鏡を導入し製品開発を加速 (3M Newsroom)

技術新規性●●●●○ 市場インパクト●●●●○ 日本関連度●●○○○

原子レベルでの材料理解は、接着剤や機能性材料のブレークスルーに不可欠。R&D;基盤への投資は競争力強化に直結する。

米熱界面材料市場、2033年までにEVバッテリーパックの熱ギャップフィラー需要で大幅成長 (Marks Park Solutions)

技術新規性●○○○○ 市場インパクト●●●●○ 日本関連度●●●●●

EVバッテリーの熱管理は安全性と性能の鍵。熱ギャップフィラーの需要増は、日本のTIMメーカーにとって大きな市場機会となる。

複数の企業がTPO・IBOAフリーのUV硬化型接着剤を発表 — EU規制強化に対応し医療・構造用途に革新 (Assembly Magazine)

技術新規性●●●○○ 市場インパクト●●●○○ 日本関連度●●○○○

EUの環境規制強化は、接着剤メーカーに新たな材料開発を促す。TPO/IBOAフリーは医療・EV分野で差別化要因となる。

今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

■ 即時（今週中）

- 【調達】 AI半導体向け主要材料（ABF、封止材など）のサプライヤーと供給契約状況を再確認し、潜在的な供給リスクを評価する。
- 【R&D】 AI半導体パッケージングの最新技術動向（光学-ロジック統合、ハイブリッドボンディング）に関する社内勉強会を企画・実施する。

■ 短期（1ヶ月）

- 【EV設計】 EVバッテリーパックにおける熱界面材料（TIM）および次世代バインダー（例：BASFのPIB）の最新情報を収集し、自社製品への適用可能性を検討する。
- 【R&D】 TPO・IBOAフリーUV硬化型接着剤やリサイクル可能な衛生接着剤など、環境対応型接着剤のサンプル評価を開始し、自社製品への導入可能性を調査する。
- 【経営企画】 M&A動向を注視し、特に医療用接着剤分野におけるH.B. Fullerのような大手企業の動きが自社事業に与える影響を分析する。

■ 中長期（四半期～）

- 【R&D】 原子レベル解析技術（STEMなど）の導入または外部機関との連携を検討し、材料開発のスピードと精度向上に向けたロードマップを策定する。
- 【経営企画】 AI半導体やEVバッテリーといった成長市場における接着・封止材の長期的な需要予測に基づき、生産能力増強や新規事業投資の戦略を立案する。
- 【全社】 サプライチェーン全体のレジリエンス強化とカーボンニュートラル達成に向けた具体的な目標設定と実行計画を策定し、進捗を定期的にレビューする。

接着・封止材 採用記事全文集

出力日: 2026-06-20

採用記事数: 21 件

収録記事一覧

- #01 レゾナック、生成AI向け2.5D半導体パッケージ用液状封止材特許が有効維持 — 信頼性課題を解決
- #02 味の素、AI需要急増に対応し半導体材料「ABF」供給能力を2030年まで確保へ — 価格据え置きで増産計画
- #03 ヘンケル南アフリカ、アルローデ工場で太陽光発電導入によりカーボンニュートラル達成 — 稼働電力の65%を賄う
- #04 複数の企業がTPO・IBOAフリーのUV硬化型接着剤を発表 — EU規制強化に対応し医療・構造用途に革新
- #05 ヘンケル、サグラダ・ファミリア中央塔完成にLoctite EA 9497構造用接着剤で貢献 — 24トン使用し工期短縮と耐久性確保
- #06 BASF、Battery Show Europe 2026で次世代EV固体電池向け高性能PIBバインダー「Oppanol® N PLUS」を発表
- #07 Sihl、偽造防止を強化するデュアル機能セキュリティラベル材料を新発売
- #08 ヘンケル、Interpack 2026で低CO₂ホットメルトや溶剤フリー積層接着剤など持続可能なパッケージングソリューションを展示
- #09 半導体工学レポート、AI駆動の光学-ロジック統合加速とハイブリッドボンディングによる接続密度向上を強調
- #10 自動車軽量化の鍵：バッテリーパックと多素材BIWで接着剤が果たす役割と最新動向
- #11 Bostikの衛生接着剤「Kizen® Miles 9.0」がINDEX™ 26 Awards受賞、リサイクル性に75%再生可能材料を貢献
- #12 米熱界面材料市場、2033年までにEVバッテリーパックの熱ギャップフィラー需要で大幅成長
- #13 レゾナック、生成AI向け2.5D半導体液状封止材の特許有効性を日本特許庁が維持
- #14 3M VHB 4920アクリルフォームテープ、AIサーバーやEV向け高強度接合ソリューションを提案
- #15 レゾナックCEO、AIチップ需要急増と中国サプライチェーンリスクを両立させる戦略を強調
- #16 H.B. Fuller、2030年までの持続可能性目標と革新への注力：新航空宇宙センター開設も
- #17 Advanced Medical Solutions、H.B. Fullerからの買収提案交渉期限を2026年7月2日まで延長
- #18 3M、原子レベルの材料解析を可能にする新走査型透過電子顕微鏡を導入し製品開発を加速
- #19 味の素、AI需要急増下のABF価格据え置き戦略で投資家のポートフォリオ再構築を問う
- #20 AI需要拡大で味の素ABFが供給逼迫の試練に直面、価格戦略が焦点に
- #21 PU接着剤市場、自動車エレクトロニクス小型化と熱管理の進化で拡大：3M、Henkel、Dowが主導

レゾナック、生成AI向け2.5D半導体パッケージ用液状封止材特許が有効維持 — 信頼性課題を解決

公開日 2026年06月17日 Resonac 日本



概要

レゾナックは、生成AI向け2.5D半導体パッケージに用いられる液状封止材に関する日本特許（特許番号7687499）の有効性が日本特許庁によって維持されたと発表しました。この封止材技術は、半導体パッケージにおける熱膨張差による応力やクラック発生といった信頼性課題を解決するものです。同社は、特定の熱膨張係数と弾性率の範囲内で樹脂と添加剤を最適化することで、この高信頼性を実現しています。この特許維持は、AI半導体市場におけるレゾナックの技術的優位性を確固たるものとし、今後の高密度パッケージング技術の発展に貢献することが期待されます。

詳細

主要成果

レゾナックは2026年6月17日、生成AIアプリケーション向け2.5D半導体パッケージに不可欠な液状封止材に関する日本特許（特許番号7687499）が、日本特許庁によって有効であると最終的に認められたと発表しました。この決定は、同社の革新的な材料技術が、高度な半導体パッケージの信頼性向上に大きく貢献することを裏付けるものです。

技術詳細

この特許技術は、異なる材料間で生じる熱膨張係数の差に起因する応力集中やクラック発生といった、2.5D半導体パッケージが抱える主要な信頼性課題に対処するために開発されました。レゾナックは、特定の範囲内で熱膨張係数と弾性率を緻密に制御できるよう、独自の樹脂組成と添加剤の最適化を行いました。これにより、半導体チップとパッケージ基板間の界面における機械的ストレスを効果的に緩和し、製品の長寿命化と安定稼働を実現します。

背景・業界文脈

生成AIの急速な普及に伴い、高性能なAIプロセッサの需要が飛躍的に増加しています。これらのプロセッサは、複数の半導体チップを垂直または水平に統合する2.5D/3Dパッケージング技術を駆使して製造されており、各層間の接着・封止材には極めて高い信頼性が求められます。従来の封止材では、複雑な構造と高発熱環境下での長期使用において、熱サイクルによる材料劣化や信頼性低下が懸念されていました。レゾナックの技術は、このボトルネックを解消し、次世代AI半導体の量産体制を支える基盤技術として期待されています。

今後の展望

今回の特許有効性維持は、レゾナックがAI半導体材料分野におけるリーディングカンパニーとしての地位を強化するものです。同社は今後も、高機能材料の研究開発を加速させ、半導体業界のさらなる進化に貢献していく方針です。特に、データセンターの電力消費増大やエッジAIデバイスの普及に伴い、放熱性や耐久性に優れた封止材の需要はさらに高まることが予想され、レゾナックの技術は市場で重要な役割を果たすでしょう。

元記事: <https://www.resonac.com/news/2026/06/17/3865.html>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

味の素、AI需要急増に対応し半導体材料「ABF」供給能力を2030年まで確保へ — 価格据え置きで増産計画

公開日 2026年06月15日 GIGAZINE 日本



概要

味の素は、AIチップ需要の急増にもかかわらず、先進半導体パッケージ基板の主要な層間絶縁材料である「味の素ビルドアップフィルム（ABF）」の需要に2030年まで対応できる見込みを表明しました。同社は、価格を引き上げるのではなく、生産能力の拡大を通じて供給体制を強化する計画です。ABFは、高密度なチップとプリント基板の統合に不可欠であり、ガラスなどの代替材料との併用も視野に入れつつ、引き続き重要な役割を果たすと予測されています。この戦略は、顧客への安定供給と市場シェア維持を目指すものです。

詳細

主要成果

味の素は2026年6月15日、AIチップ需要の爆発的な増加にもかかわらず、高性能半導体パッケージ基板の核心材料である「味の素ビルドアップフィルム（ABF）」の供給を2030年まで安定的に確保できるとの見通しを発表しました。同社は市場価格を据え置き、生産能力の積極的な増強によって需要に対応する戦略を採用しています。

技術・製品詳細

ABFは、半導体パッケージ基板において、複数の回路層を電氣的に絶縁し、同時に微細配線を形成するための積層材料です。特にAIチップのような高集積・高機能な半導体では、電気信号の高速伝送と熱管理が重要となり、ABFはその低誘電率と低誘電正接という優れた電気特性、および良好な熱安定性によって、チップとプリント基板の高密度な統合を可能にします。味の素は、この材料の製造プロセスを高度に最適化し、品質と生産効率を両立させています。現在、ガラスなどの新規材料も次世代半導体基板の候補として浮上していますが、ABFはこれらの新素材と組み合わせて使用されることで、その機能性と市場価値をさらに高めることが期待されています。

背景・業界文脈

生成AI技術の発展は、データセンターやエッジデバイスにおける計算能力の飛躍的な向上を促し、これに伴い高性能AI半導体の需要が過去に例を見ない規模で拡大しています。半導体メーカー各社は、より多くのトランジスタを搭載し、より高速なデータ処理を可能にするために、チップレット技術や高密度パッケージング技術の採用を進めています。ABFは、これらの先進パッケージング技術の性能を最大限に引き出すための鍵となる材料であり、その安定供給は半導体産業全体の成長に直結します。供給網の安定性は、世界的な半導体不足の経験から、ますます重要視されており、味の素の供給計画は業界にとって朗報と言えるでしょう。

今後の展望

味の素の生産能力拡大計画は、競合他社が価格引き上げに走る中で、市場における同社の競争力を一段と高める可能性があります。2030年までの安定供給のコミットメントは、主要な半導体顧客にとって大きな安心材料となり、長期的なパートナーシップの強化に繋がるでしょう。AI技術の進化が続く限り、ABFのような高性能材料の需要は持続的に成長すると見込まれており、味の素は、技術革新と供給体制の強化を通じて、この重要な市場でのリーダーシップを維持していく方針です。同社の戦略は、半導体業界全体の安定と発展に寄与するものです。

元記事: https://gigazine.net/gsc_news/en/20260615-ajinomoto-abf-product-more/

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

ヘンケル南アフリカ、アルローデ工場で太陽光発電導入によりカーボンニュートラル達成 — 稼働電力の65%を賄う

公開日 2026年06月11日 Engineering News 南アフリカ



概要

ヘンケル南アフリカのアルローデ生産施設は、2026年6月以降、ネットゼロエミッションで稼働し、カーボンニュートラルを達成しました。これは、1.8 MWpの太陽光発電設備の導入により、工場電力の65%を供給し、さらに化石燃料から電気エネルギーへの転換を進めた結果です。この取り組みは、接着剤技術製品の製造事業において、ヘンケルが持続可能性を統合するコミットメントを示すものです。今回の達成は、製造業における環境負荷低減の模範事例として注目されます。

詳細

主要成果

ヘンケル南アフリカのアルローデ生産施設は、2026年6月をもってネットゼロエミッションを達成し、製造工程におけるカーボンニュートラルを実現しました。これは、大規模な太陽光発電システムの導入と、化石燃料からのエネルギー転換戦略が功を奏した結果です。

技術・導入詳細

アルローデ工場におけるカーボンニュートラル達成の主要因は、工場敷地内に設置された1.8 MWp（メガワットピーク）の太陽光発電設備です。この設備は、工場が必要とする電力の約65%を再生可能エネルギーで賄っています。残りの電力需要についても、南アフリカの電力供給会社からの再生可能エネルギー購入や、オフセットクレジットの活用を通じてネットゼロを達成しました。さらに、暖房やその他のプロセスで使用されていた化石燃料を、高効率の電動システムに置き換えることで、直接的な排出量も大幅に削減されています。この包括的なアプローチにより、工場全体の温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることが可能となりました。

背景・業界文脈

世界的に気候変動対策への意識が高まる中、製造業においてもカーボンフットプリントの削減は喫緊の課題です。多くの企業がサプライチェーン全体での排出量削減目標を設定し、再生可能エネルギーへの移行を進めています。ヘンケルは、2040年までに全事業でクライメートポジティブ（気候変動に貢献する活動）を達成するという野心的な目標を掲げており、今回のアルローデ工場の事例はその目標達成に向けた重要なマイルストーンとなります。特に、接着剤技術の製造はエネルギー集約型であり、このような大規模工場でのカーボンニュートラル達成は、業界全体の持続可能性目標達成に向けた強力なメッセージとなります。

今後の展望

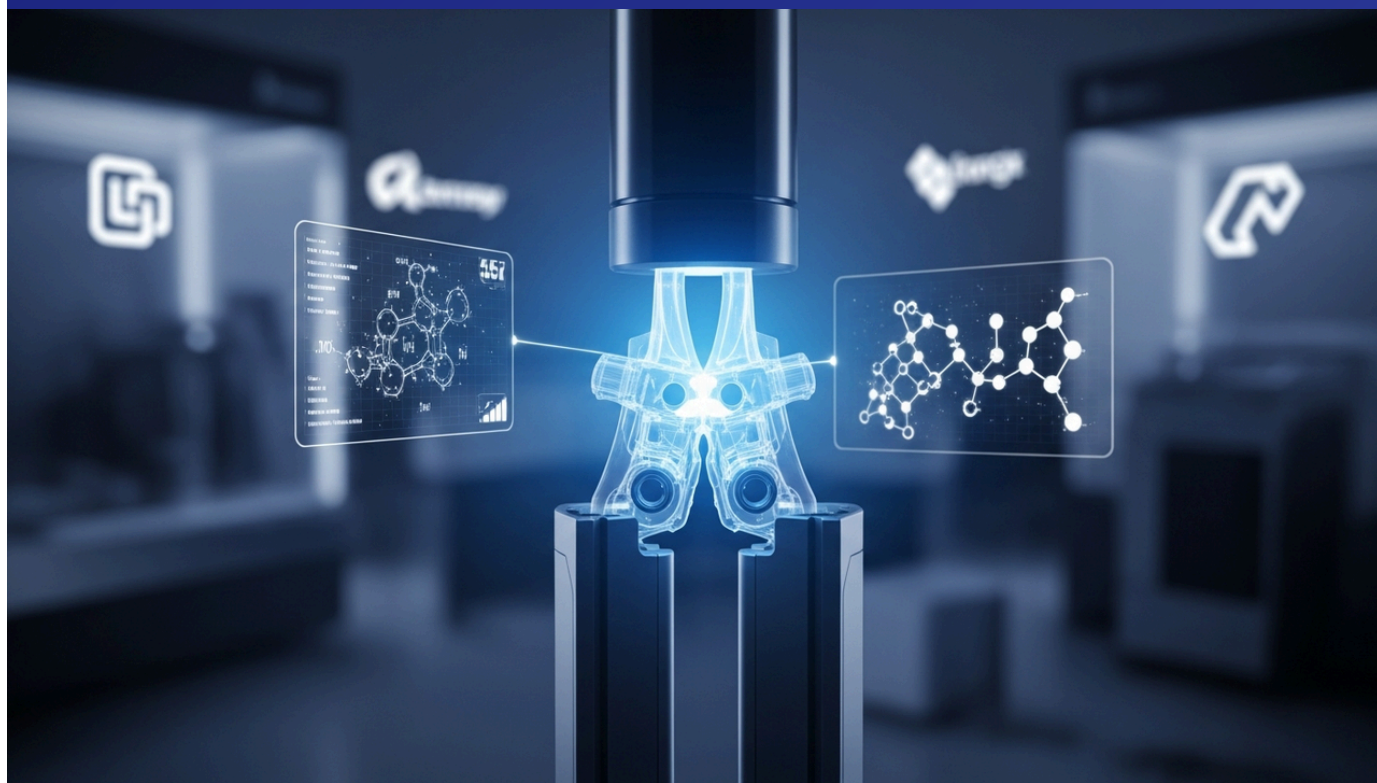
アルローデ工場のカーボンニュートラル達成は、ヘンケルのグローバルな持続可能性戦略における成功事例として、他の生産施設への展開を加速させるインセンティブとなるでしょう。この取り組みは、顧客や投資家に対して、持続可能な製造プロセスへの同社のコミットメントを明確に示し、企業のブランド価値向上にも寄与します。今後、ヘンケルは、接着剤製品そのものの環境性能向上と並行して、製造プロセス全体の脱炭素化をさらに推進していくことが予想されます。これにより、気候変動への対応をビジネス戦略の中核に据える企業のロールモデルとしての地位を確立する可能性があります。

元記事: <https://www.engineeringnews.co.za/article/carbon-neutrality-advanced-with-major-emissions-reduction-at-henkel-factory-2026-06-11>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

複数の企業がTPO・IBOAフリーのUV硬化型接着剤を発表 — EU規制強化に対応し医療・構造用途に革新

公開日 2026年06月19日 Assembly Magazine ドイツ



概要

EU規制強化に対応し、Delo Industrial Adhesives、Dymax、Hoenleなどの主要企業が、TPOやIBOAを含まない新しいUV硬化型接着剤を相次いで発表しました。Deloの構造用途向け「Photobond MG4202」やDymaxの医療機器向け「HLC-M-1004」、HoenleのREACH対応製品などが市場投入され、特に医療分野での安全性が向上します。さらにWevo-Chemie GmbHはEVバッテリーハウジング向けのシリコンシーラント「Wevosil 23130」も発表しており、これらの革新的な材料は、環境規制の強化と高性能化の要求に応え、多岐にわたる産業分野での応用を拡大します。

詳細

主要成果

EUにおける化学物質規制の強化を受け、Delo Industrial Adhesives、Dymax、Hoenleといった主要な接着剤メーカーが、有害物質であるTPO（トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド）やIBOA（イソボルニルアクリレート）を含まない新しいUV硬化型接着剤を市場に投入しました。これらの製品は、特に医療機器組立や構造接着といった高感度なアプリケーションにおいて、安全性と性能を両立させる画期的なソリューションを提供します。また、Wevo-Chemie GmbHは、EVバッテリーの熱暴走対策としてガス・煙の放出を防ぐシリコンシーラントも発表し、接着・封止材業界全体で環境配慮と高機能化が加速しています。

技術詳細

- **Delo Industrial Adhesives:** 構造接着用途向けに「Photobond MG4202」を含む5種類の新しいUV硬化型接着剤を発表。これらの製品は、IBOAやTPOを含まない配合でありながら、高い接着強度と耐久性を維持します。特に、自動車部品や電子機器の組み立てにおいて、環境規制を遵守しながら高性能な接合を実現します。
- **Dymax:** 医療機器組立用の低粘度ハイブリッド光硬化型接着剤「HLC-M-1004」を強調。この接着剤は、光が届かない影の部分でも硬化する能力を持ち、ISO 10993生体適合性基準を満たしています。カテーテルなどの複雑な医療機器の製造において、設計の自由度と生産効率を向上させます。
- **Hoenle:** 医療機器組立向けにREACH（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）規制に準拠し、CMR（発がん性・変異原性・生殖毒性）物質フリーのUV硬化型接着剤を開発。これにより、医療従事者と患者の安全性が確保されるとともに、よりクリーンな製造環境が実現されます。
- **Wevo-Chemie GmbH:** 電気自動車（EV）バッテリーハウジング向けのシリコンシーラント「Wevosil 23130」を開発。このシーラントは、バッテリーの熱暴走時に発生するガスや煙の放出を効果的に抑制し、乗員の安全性を高めます。優れた耐熱性とシーリング性能により、EVバッテリーシステムの信頼性向上に貢献します。

背景・業界文脈

EUでは、化学物質の安全性に関する規制が年々厳しくなっており、特にTPOやIBOAのような特定の化学物質の使用には制限が設けられています。これは、作業員の健康保護や環境負荷低減を目的としたものです。これらの規制強化は、接着剤メーカーにとって、代替材料の開発や既存製品の再設計を促す大きな圧力となっています。同時に、医療機器、電気自動車、高性能電子機器といった産業分野では、小型化、高機能化、高信頼性への要求が強まっており、接着・封止材にはこれらを両立する革新的なソリューションが求められています。各社の新製品は、これらの市場のニーズと規制の動向に的確に応えるものです。

今後の展望

TPO・IBOAフリーのUV硬化型接着剤の普及は、接着剤市場全体の持続可能性を高める上で重要な一歩となります。これらの製品は、医療機器メーカーがより安全で革新的な製品を開発するための新たな道を開き、同時に製造現場でのリスクを低減します。EVバッテリー向けの高性能シーラントの登場は、電気自動車の安全性と普及を加速させる上で不可欠な要素です。今後、接着・封止材業界では、環境規制への対応と機能性向上を両立する「グリーンケミストリー」の原則に基づいた材料開発がさらに活発化し、新たな市場機会を創出していくことが予想されます。

元記事: <https://www.assemblymag.com/articles/100146-new-uv-cure-adhesives-do-not-contain-tpo>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

ヘンケル、サグラダ・ファミリア中央塔完成にLoctite EA 9497構造用接着剤で貢献 — 24トン使用し工期短縮と耐久性確保

公開日 2026年06月17日 Henkel ドイツ



概要

ヘンケルは、サグラダ・ファミリア中央塔のモジュール式建設に、高機能構造用接着剤「Loctite EA 9497」が不可欠な役割を果たしたと発表しました。ガウディ没後100周年と重なるこの節目に、24トン以上の接着剤が石材と鉄骨部品の接合に使用され、これらを一体の構造ユニットとして機能させました。この技術は、建設のスピードアップと長期的な耐久性の確保に大きく貢献しています。歴史的建造物の現代的な建設に革新的な材料が応用された好例です。

詳細

主要成果

ヘンケルは2026年6月17日、スペインの象徴的な建築物であるサグラダ・ファミリア中央塔のモジュール式建設において、同社の先進的な構造用接着剤「Loctite EA 9497」が極めて重要な役割を果たしたと発表しました。この技術は、建設プロセスを大幅に加速させながら、構造の長期的な耐久性を保証する上で決定的な要素となりました。

技術詳細

Loctite EA 9497は、エポキシ樹脂をベースとした高性能な構造用接着剤であり、特に異なる種類の材料を強固に接合する能力に優れています。サグラダ・ファミリアの中央塔建設では、プレハブ化された石材モジュールと内部の鉄骨構造を一体化させるために、24トン以上のこの接着剤が使用されました。この接着剤は、高いせん断強度と剥離強度を持ち、硬化後には非常に高い耐環境性（温度変化、湿度、紫外線など）を発揮します。これにより、石材と鉄骨が単一の構造ユニットとして機能し、荷重を均等に分散させることが可能になりました。モジュール式工法と高性能接着剤の組み合わせは、従来の石積みやモルタル接合に比べて、施工精度と工期の両面で大きな利点をもたらしました。

背景・業界文脈

サグラダ・ファミリアは、アントニ・ガウディの未完の傑作であり、彼の没後100周年に中央塔の完成を目指すという壮大なプロジェクトが進行していました。歴史的建造物の修復や完成には、伝統的な美学と現代の工学技術の融合が求められます。特に、モジュール式工法は、現場での作業量を減らし、安全性と品質を向上させる現代建築のトレンドですが、異なる材料間の信頼性高い接合が課題となります。ヘンケルのLoctite EA 9497は、この課題に対して、時間とコストの効率化を図りながら、ガウディのビジョンに忠実な構造美と、21世紀にふさわしい構造的完全性を提供しました。

今後の展望

今回のサグラダ・ファミリアでの成功事例は、高性能接着剤が建築・建設業界、特に大規模かつ複雑な構造物の建造において、どれほど革新的な役割を果たしうるかを示すものです。Loctite EA 9497のような接着技術は、従来の機械的接合や溶接に代わる、より軽量で美観に優れ、かつ耐久性の高いソリューションとして、今後の建築プロジェクトで広く採用される可能性があります。ヘンケルは、この実績を足がかりに、接着剤技術の適用範囲をさらに拡大し、持続可能で効率的な建設方法の普及に貢献していくでしょう。特に、プレハブ建築やモジュール建築の需要が高まる中で、接着剤の果たす役割はますます重要になると予想されます。

元記事: <https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2026-06-17-henkel-technology-supports-completion-of-the-sagrada-familia-s-central-towers-2171148>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

BASF、Battery Show Europe 2026で次世代EV固体電池向け高性能PIBバインダー「Oppanol® N PLUS」を発表

公開日 2026年06月16日 SpecialChem ドイツ



概要

BASFは、Battery Show Europe 2026で、次世代EVバッテリー、特に固体電池向けに設計された高性能ポリイソブテン (PIB) バインダー「Oppanol® N PLUS」を発表しました。高い弾性と一貫した品質を特徴とするこのバインダーは、正極、負極、または電解質の個々の構成要素を結びつけ、機械的ストレスを補償することでバッテリーの寿命と安定性に貢献します。この革新的なバインダー技術は、固体電池の実用化における主要な課題の一つを解決し、EVの航続距離と安全性を向上させる可能性を秘めています。

詳細

主要成果

BASFは2026年6月16日、Battery Show Europe 2026において、次世代の電気自動車（EV）バッテリー、特に期待される固体電池向けに開発された、高性能ポリイソブテン（PIB）バインダー「Oppanol® N PLUS」を発表しました。この新材料は、高い弾性と卓越した品質安定性を特徴とし、バッテリーの寿命と全体的な安定性を大幅に向上させる可能性を秘めています。

技術詳細

Oppanol® N PLUSは、その優れた高弾性特性により、固体電池のような構造が脆弱になりがちなバッテリーシステムにおいて、正極、負極、または固体電解質などの個々の構成要素を効果的に結びつけます。特に、固体電池では、充放電サイクル中に電極材料が膨張・収縮する際に発生する機械的ストレスが、電極と電解質の界面剥離やクラック形成を引き起こし、バッテリー性能の劣化や寿命短縮の主要因となっていました。Oppanol® N PLUSは、この機械的ストレスを柔軟に吸収・補償することで、界面の安定性を保ち、高サイクル寿命と高エネルギー密度を両立させます。また、一貫した品質は、大量生産における信頼性と再現性を保証し、固体電池の商用化を加速させる上で不可欠な要素となります。

背景・業界文脈

電気自動車の普及をさらに進めるためには、現在主流のリチウムイオン液体電解質電池が抱える安全性、航続距離、充電速度、コストといった課題を克服する必要があります。固体電池は、不燃性の固体電解質を使用することで安全性を劇的に向上させ、高エネルギー密度化によって航続距離を延長できる次世代バッテリーとして大きな期待が寄せられています。しかし、固体電解質と電極間の界面抵抗や、電極の体積変化への追従性など、実用化にはまだ多くの技術的障壁が存在します。BASFのOppanol® N PLUSは、これらの障壁の一つである機械的安定性に対する画期的な解決策を提供し、固体電池の実用化を大きく前進させるものとして注目されています。

今後の展望

Oppanol® N PLUSの市場投入は、固体電池の開発競争に新たな弾みをつけるでしょう。この高性能バインダーの採用は、固体電池を搭載したEVの航続距離を延長し、充電時間を短縮し、安全性を向上させることに直結します。BASFは、この製品を通じて、EVバッテリー技術の進化に貢献し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた重要な役割を担っていく方針です。今後、自動車メーカーやバッテリーセルメーカーとの連携を深め、Oppanol® N PLUSを固体電池の標準材料として確立することで、世界のEV市場のさらなる拡大に寄与することが期待されます。この革新は、バッテリー業界のエンジニアや研究者、投資家にとって、非常に興味深い技術進展と言えるでしょう。

元記事: <https://www.specialchem.com/coatings/news/ev-battery-binder-technology-at-the-battery-show-europe-by-basf>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

Sihl、偽造防止を強化するデュアル機能セキュリティラベル材料を新発売

公開日 2026年06月11日 Labels & Labeling スイス



概要

Sihlは2026年6月11日、新しいデュアル機能セキュリティラベル材料を発売しました。この製品は、様々なパッケージングおよびラベリング用途向けに強化されたセキュリティ機能を提供するように設計されており、顕在的（目に見える）および潜在的（目に見えない）なセキュリティ要素を統合しています。この革新的なラベルは、偽造品の流入を防ぎ、ブランドの完全性を保護する上で重要な役割を果たします。これにより、企業は製品の真正性を消費者に保証し、市場における信頼性を高めることができます。

詳細

主要成果

SiHLは2026年6月11日、偽造防止とブランド保護を目的とした画期的なデュアル機能セキュリティラベル材料を新たに市場に投入しました。この製品は、多様なパッケージングおよびラベリングアプリケーションにおいて、より高度なセキュリティ対策を提供するために設計されています。

技術詳細

新開発されたデュアル機能セキュリティラベル材料は、二つの主要なセキュリティ要素を統合しています。一つは「顕在的セキュリティ要素」であり、これは消費者が肉眼で容易に識別できる特徴（例: 特殊な印刷インク、ホログラム、視覚的テクスチャ）です。もう一つは「潜在的セキュリティ要素」であり、これは特殊な機器や専門知識がなければ検出できない隠れた特徴（例: マイクロテキスト、UV反応性インク、隠しコード）です。これらの要素を組み合わせることで、偽造者はラベルを再現するのが極めて困難となり、製品の真正性を多層的に保護します。このラベル材料は、既存のラベリングプロセスにも容易に統合できるように設計されており、高い耐久性と印刷適性を持ち、様々な製品パッケージに適用可能です。

背景・業界文脈

世界的に偽造品の流通は拡大の一途をたどっており、特に高級品、医薬品、電子機器、食品など、製品の信頼性が重視される分野では深刻な問題となっています。偽造品は、消費者に経済的損失をもたらすだけでなく、健康被害やブランドイメージの毀損、企業の収益損失に直結します。従来のセキュリティラベルでは、偽造技術の巧妙化に伴い、十分な保護を提供できないケースが増えていました。SiHLの新材料は、このような現状に対応し、より強固な偽造防止対策を求める市場のニーズに応えるものです。多機能なセキュリティ要素を一体化した材料は、サプライチェーン全体での製品追跡と検証を簡素化し、企業が消費者に提供する信頼感を向上させます。

今後の展望

Sihlのデュアル機能セキュリティラベル材料は、偽造対策技術の新たな標準を確立する可能性を秘めています。この材料の導入により、企業は製品の真正性をより確実に保護し、消費者の購買意欲を高めることができます。特に、グローバル市場での製品流通が増加する中で、越境ECなどでの偽造リスクは常に存在します。Sihlの技術は、これらのリスクを軽減し、ブランドが世界中でその価値を守るための強力なツールとなるでしょう。同社は、この新製品を通じて、パッケージングおよびラベリング業界におけるリーダーシップを強化し、持続可能なサプライチェーンの安全性と信頼性の向上に貢献していく方針です。この革新は、製品ブランドオーナーや物流業者にとって、極めて重要な意味を持つでしょう。

元記事: #

ヘンケル、Interpack 2026で低CO₂ホットメルトや溶剤フリー積層接着剤など持続可能なパッケージングソリューションを展示

公開日 2026年06月15日 Henkel ドイツ



概要

ヘンケル・アドヒーズブテクノロジーズは、Interpack 2026で持続可能なパッケージング設計向けの接着剤およびコーティングポートフォリオを展示します。これには、低CO₂ホットメルト、ペットフードのレトルトパウチのような高い熱ストレスに耐える溶剤フリー積層接着剤（LOCTITE LIOFOL LA 7837 / LA 6265）、およびバリアコーティングが含まれます。これらの製品はすべて、循環型で未来志向のパッケージングを加速させることを目的としています。今回の展示は、パッケージング業界における環境負荷低減と機能性向上へのヘンケルのコミットメントを明確に示すものです。

詳細

主要成果

ヘンケル・アドヒーズテクノロジーズは、Interpack 2026において、持続可能なパッケージング設計を推進するための広範な接着剤およびコーティング製品ポートフォリオを展示すると発表しました。これらのソリューションは、パッケージングの環境フットプリントを削減しつつ、高い機能性と安全性を維持することに焦点を当てています。

技術詳細

ヘンケルがInterpack 2026で紹介する主要な持続可能パッケージングソリューションは以下の通りです。

- **低CO₂ホットメルト接着剤**：製造プロセスにおける二酸化炭素排出量を削減したホットメルト接着剤です。これらの接着剤は、高い接着強度と生産効率を維持しながら、パッケージング全体の持続可能性向上に貢献します。主に段ボールや紙器の封函用途で活用されます。
- **溶剤フリー積層接着剤（LOCTITE LIOFOL LA 7837 / LA 6265）**：溶剤を使用しないことで、製造過程でのVOC（揮発性有機化合物）排出をゼロにし、作業環境と環境への影響を大幅に低減します。特に「LOCTITE LIOFOL LA 7837 / LA 6265」は、ペットフードのレトルトパウチなど、高い熱ストレスを受けるパッケージング用途に適しており、優れた接着強度と耐久性を提供します。
- **バリアコーティング**：パッケージング材料に直接塗布することで、酸素や水分などの透過を防ぎ、製品の鮮度と保存期間を延長します。これにより、プラスチックフィルムの多層構造を簡素化し、リサイクル性を向上させる可能性を秘めています。

これらの技術は、軽量化、リサイクル性の向上、再生可能資源の利用、および廃棄物削減といった、循環型経済の原則に基づいています。

背景・業界文脈

世界的にプラスチック廃棄物問題と気候変動への関心が高まる中、パッケージング業界は、環境負荷の低いソリューションへの移行を迫られています。消費者の意識変化、厳しい規制、そして企業のESG（環境・社会・ガバナンス）目標達成の必要性から、持続可能なパッケージングは喫緊の課題となっています。従来のパッケージング材料や接着剤は、リサイクルが困難な複合材料を使用したり、製造過程で環境負荷の高い溶剤を排出したりすることがありました。ヘンケルの新しいソリューションは、これらの課題に対応し、パッケージングのライフサイクル全体での環境性能を向上させることを目指しています。特に、食品包装における安全性と鮮度保持の要求を満たしつつ、リサイクル性を確保する技術は、市場で高く評価されています。

今後の展望

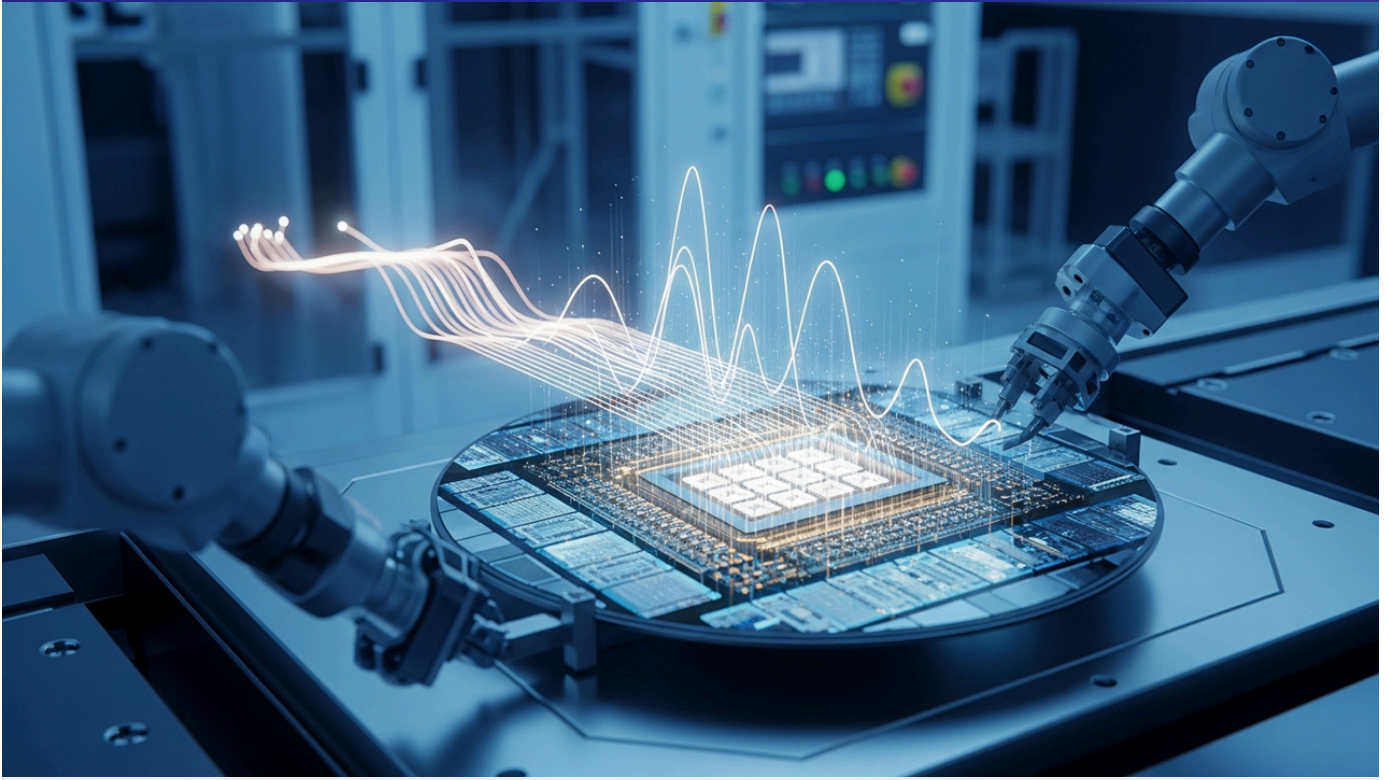
ヘンケルがInterpack 2026で発表する持続可能なパッケージングソリューションは、パッケージング業界におけるイノベーションを加速させ、より環境に優しく、かつ機能的な製品の普及に貢献するでしょう。特に、溶剤フリー技術やバリアコーティングの進化は、プラスチックの使用量削減やモノマテリアル化（単一素材化）を促進し、パッケージングのリサイクル性を飛躍的に高める可能性があります。ヘンケルは、接着剤技術のリーダーとして、顧客企業が持続可能性目標を達成するためのパートナーとなり、循環型経済への移行を支援していく方針です。この取り組みは、環境意識の高い消費者や、ESG投資に関心のある投資家にとって、非常に魅力的な企業戦略として評価されるでしょう。

元記事: <https://next.henkel-adhesives.com/at/en/events/interpack-2026-henkel-solutions.html>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

半導体工学レポート、AI駆動の光学-ロジック統合加速とハイブリッドボンディングによる接続密度向上を強調

公開日 2026年06月18日 Semiconductor Engineering アメリカ



概要

Semiconductor Engineeringの2026年6月レポートは、AIシステムが光学部品とロジックチップの統合を加速させていると指摘しています。これにより、製造、パッケージング、熱管理、材料、テスト技術の共進化が、スケーラブルな製造に不可欠となっています。特に、ハイブリッドボンディング技術は、前例のない接続密度を実現し、Intel FoundryのLori Scott氏がECTC 2026でEMIB-T、コパッケージドオプティクス、ガラスパッケージングの進展について言及しました。

詳細

主要成果

Semiconductor Engineeringの2026年6月のレポートは、AIシステムが光学技術とロジックチップの密接な統合を推進しており、スケーラブルな半導体製造のためには、製造プロセス、パッケージング、熱管理、材料、およびテスト技術の包括的な共進化が不可欠であることを強調しています。この統合の最前線にあるのが、前例のない接続密度を可能にするハイブリッドボンディング技術です。さらに、Intel FoundryのLori Scott氏がECTC 2026で、EMIB-T、コパッケージドオプティクス、およびガラスパッケージングの分野における最新の進展について詳細に解説し、業界の技術革新の方向性を示しました。

技術・臨床詳細

- **AI駆動型光学-ロジック統合:** AIアプリケーションは膨大なデータ処理を必要とし、チップ間のデータ転送速度がボトルネックとなりがちです。光学部品をロジックチップに直接統合することで、電気信号の限界を超える高速・低消費電力のデータ通信が可能になります。この統合は、設計から製造まで、エコシステム全体での協調的な技術開発を必要とします。
- **ハイブリッドボンディング:** ウエハまたはダイレベルで直接的な銅-銅接合を形成する技術であり、従来のワイヤーボンディングやフリップチップ技術では不可能だった極めて高い接続密度と微細ピッチを実現します。これにより、3Dスタッキングやチップレット技術の鍵となり、帯域幅の向上と消費電力の削減に貢献します。
- **EMIB-T (Embedded Multi-die Interconnect Bridge-Tile):** Intelが開発したこの技術は、異なるチップレットを効率的に接続するためのブリッジとして機能します。高密度な接続を可能にしながらも、従来のインターポーザーに比べてコストを抑え、製造プロセスを簡素化します。
- **コパッケージドオプティクス (Co-packaged Optics):** 光送受信機を半導体パッケージ内に直接統合する技術です。これにより、データセンターのスイッチング帯域幅を劇的に向上させ、電力効率を改善します。信号経路が短くなることで、電氣的損失が最小限に抑えられます。

- **ガラスパッケージング:** 高い平坦性、低誘電損失、熱安定性を持つガラス基板をパッケージングに利用する技術です。特に高周波アプリケーションや大型インターポーターにおいて、優れた信号整合性と熱放散特性を提供し、より高性能なモジュールを可能にします。

背景・業界文脈

半導体業界は、AI、高性能コンピューティング、5G通信、自動運転といった新たなメガトレンドによって、チップの設計と製造に新たな課題を突きつけています。より高密度な集積化、低消費電力、優れた熱管理が求められる中で、従来の2Dスケーリングの限界が顕在化し、ヘテロジニアス集積化やアドバンストパッケージングが半導体産業の新たな成長ドライバーとなっています。特に、光学とロジックの統合は、データセンターの消費電力問題やAIワークロードのボトルネック解消に直結するため、業界の最重要課題の一つです。

今後の展望

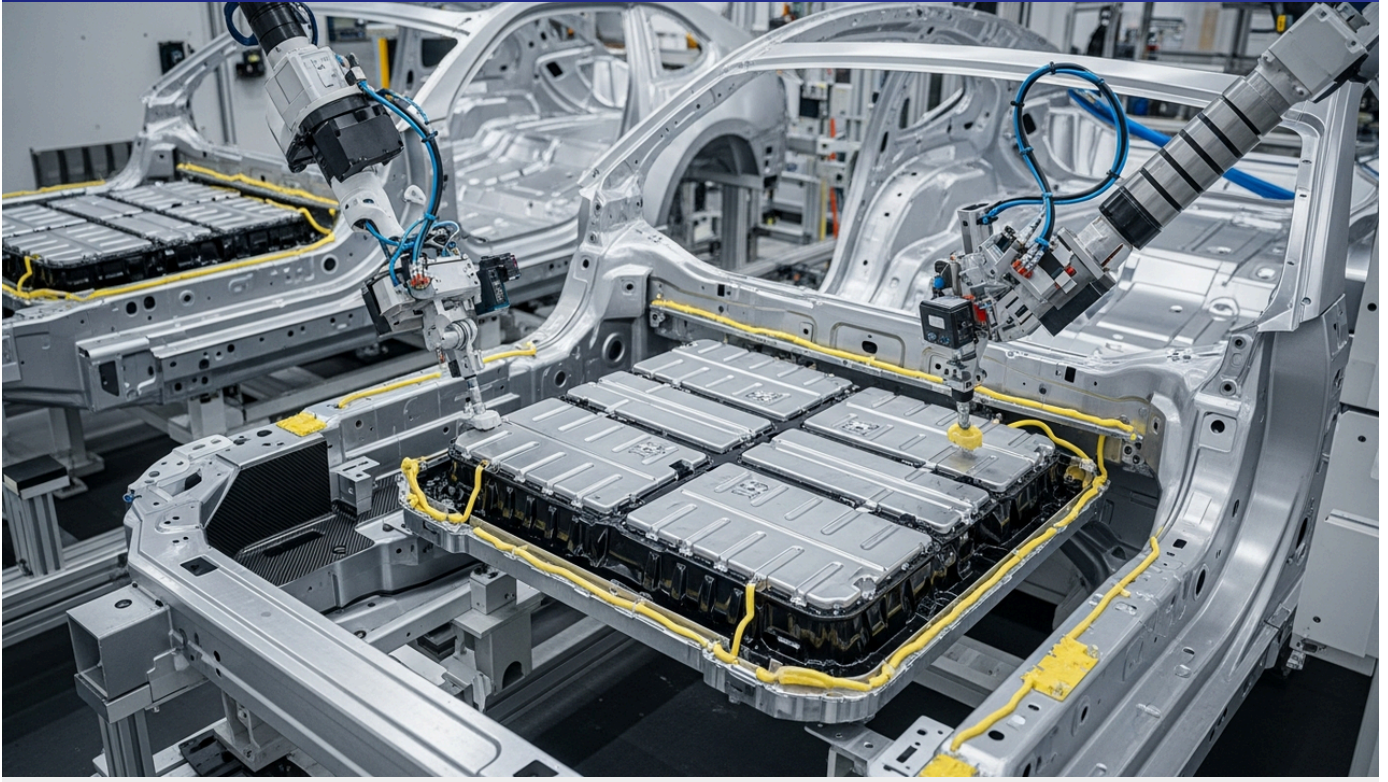
このレポートは、AIが半導体産業のすべての側面、特にパッケージングと材料開発を駆動する主要な力であることを明確に示しています。ハイブリッドボンディング、EMIB-T、コパッケージドオブティクス、ガラスパッケージングなどの技術は、今後数年間にわたる半導体イノベーションのロードマップを形成するでしょう。これらの技術が成熟し、量産化が進むことで、より高速で、より電力効率が高く、より小型な電子デバイスが実現され、AIのさらなる普及と社会全体への影響が加速すると予測されます。業界全体での協力と投資が、これらの技術革新を成功させる鍵となります。

元記事: <https://semiengineering.com/newsletter/manufacturing-packaging-materials-june-2026/>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

自動車軽量化の鍵：バッテリーパックと多素材BIWで接着剤が果たす役割と最新動向

公開日 2026年06月16日 Industrial publication/analysis (specific name not in snippet) 不明



概要

自動車産業における軽量化の進展において、接着剤の役割が特にEVバッテリーパックや多素材のボディ・イン・ホワイト（BIW）アセンブリで飛躍的に拡大しています。これらの接着剤は、従来の機械的締結具に比べて軽量設計を可能にし、部品点数を削減することで車両の全体重量を低減します。その結果、衝突安全性の向上、騒音・振動・ハーシュネス（NVH）特性の改善、そして車両の性能と燃費効率の最適化に大きく貢献します。

詳細

主要成果

自動車産業における軽量化の潮流は、接着剤技術の採用を加速させており、特に電気自動車（EV）のバッテリーパックや多素材構造のボディ・イン・ホワイト（BIW）において、その重要性が飛躍的に高まっています。接着剤は、締結具の使用を最小限に抑えつつ、複数の材料を強固に接合することで、車両の全体重量を大幅に削減し、燃費効率や航続距離の向上に貢献しています。

技術・臨床詳細

- **バッテリーパック:** EVバッテリーパックの組立において、接着剤はセルやモジュールを固定し、熱管理を改善するために使用されます。軽量化に加えて、振動減衰効果によりバッテリー寿命の延長や安全性向上に寄与します。また、熱暴走時に備えた封止材としても機能し、乗員の安全性を確保する上で不可欠です。
- **多素材BIWアSEMBリ:** 鋼鉄、アルミニウム、複合材料など、異なる素材を組み合わせたBIW構造では、接着剤が優れた異種材料接合ソリューションを提供します。これにより、溶接やリベットに比べて応力集中が緩和され、部品点数が減り、車体剛性が向上します。
- **性能向上:** 接着接合は、荷重をより広範囲に均一に分散させることで、衝突時のエネルギー吸収能力を高め、車両の衝突安全性を向上させます。また、接合部の連続性により、パネル間の隙間が埋まり、NVH（騒音・振動・ハーシュネス）特性が改善され、より快適な走行体験を提供します。

背景・業界文脈

世界的な燃費規制の強化とEV市場の拡大は、自動車メーカーに車両の軽量化を強く促しています。従来の溶接や機械的締結具では、異種材料の接合や複雑な構造への対応に限界がありました。接着剤は、これらの課題を克服するための柔軟で効率的なソリューションとして注目されており、生産ラインの自動化にも適しています。この動向は、自動車設計の自由度を高め、新たな素材の採用を促進する基盤となっています。

今後の展望

今後、自動車用接着剤市場は、EVの普及と自動運転技術の進化に伴い、さらなる成長が見込まれます。特に、バッテリー熱管理接着剤、構造用接着剤、そしてリサイクル可能な接着剤の開発が加速するでしょう。接着剤メーカーは、より高い強度、耐久性、耐熱性、そして環境性能を持つ製品を提供するため、革新的な材料とプロセスの研究開発に投資を続けていくと予想されます。これにより、未来の自動車はより安全で、効率的で、持続可能なものになるでしょう。

元記事: https://vertexaisearch.cloud.google.com/grounding-api-redirect/AUZIYQHgUzdDh-vd0LI8PEM1I4o3ItDXht4Q9BBT42p9I08Z1kWxq8KoPp6oucVlfx7YqhXxt8j-KEJenIdX9y07zd_DjJ0IUiy6egayV1lwvSKg7pvuTyn0QXjmCmJ-m6EPnw-9e7R4pD0biSQiufckVjQ6nmJP95WmUwGvsrB8e3qQpTwFuXD5hF27rgOAv4JcBHh_AFKVzYgYMFpbXyOhPXN7ZtGbf_JzpyHDAZBH6M0dylRrIDXHGLGZcqQpXQWAahm4gbsYgg=

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

Bostikの衛生接着剤「Kizen® Miles 9.0」がINDEX™ 26 Awards受賞、リサイクル性に75%再生可能材料を貢献

公開日 2026年06月17日 Adhesives & Sealants Industry Magazine フランス



概要

Bostikが開発した画期的なリサイクル可能な衛生接着剤「Kizen® Miles 9.0」が、INDEX™ 26 Awardsを受賞しました。この接着剤は、使用済み吸収性衛生製品のリサイクルプロセスを大幅に改善する目的で設計されており、製品のライフサイクル終端でコンポーネントの制御された分離を可能にします。特に注目すべきは、最大75%の再生可能材料を組み込んでいる点で、サステナビリティと循環経済への貢献が高く評価されました。

詳細

主要成果

Bostik社の革新的な衛生接着剤「Kizen® Miles 9.0」が、使い捨て吸収性衛生製品のリサイクル性を劇的に向上させる技術としてINDEX™ 26 Awardsを受賞しました。この製品は、ライフサイクル終端でのコンポーネントの容易な分離を可能にし、最大75%の再生可能材料を含有することで、持続可能な社会への貢献を明確に示しています。

技術・臨床詳細

- **リサイクル性向上:** Kizen® Miles 9.0は、特定の条件下で使い捨て吸収性衛生製品（おむつ、生理用品など）の異なる層を制御された方法で分離できる設計が特徴です。これにより、使用済み製品からの貴重な材料（例：スーパーアブソorbentポリマー、繊維）の回収が容易になり、リサイクル効率が向上します。
- **再生可能材料の活用:** この接着剤には、石油由来の原料を大幅に削減し、最大75%の再生可能（バイオベース）材料が使用されています。これは、接着剤業界における環境負荷低減の新たなベンチマークとなり、資源の持続可能性に貢献します。
- **環境性能と品質の両立:** 環境性能を高めつつも、衛生接着剤に求められる強力な接着力、柔軟性、湿気耐性といった製品性能を維持・向上させています。これにより、消費者向け製品の品質や快適性を損なうことなく、環境目標達成を支援します。

背景・業界文脈

近年、使い捨て製品による環境問題への意識が高まり、リサイクル技術の革新が喫緊の課題となっています。衛生用品業界も例外ではなく、使用済み製品の廃棄物削減と資源循環型システムへの移行が求められています。BostikのKizen® Miles 9.0は、このような市場ニーズに応える形で開発され、欧州を中心に厳しい環境規制が進む中で、業界の新たな標準となる可能性を秘めています。

今後の展望

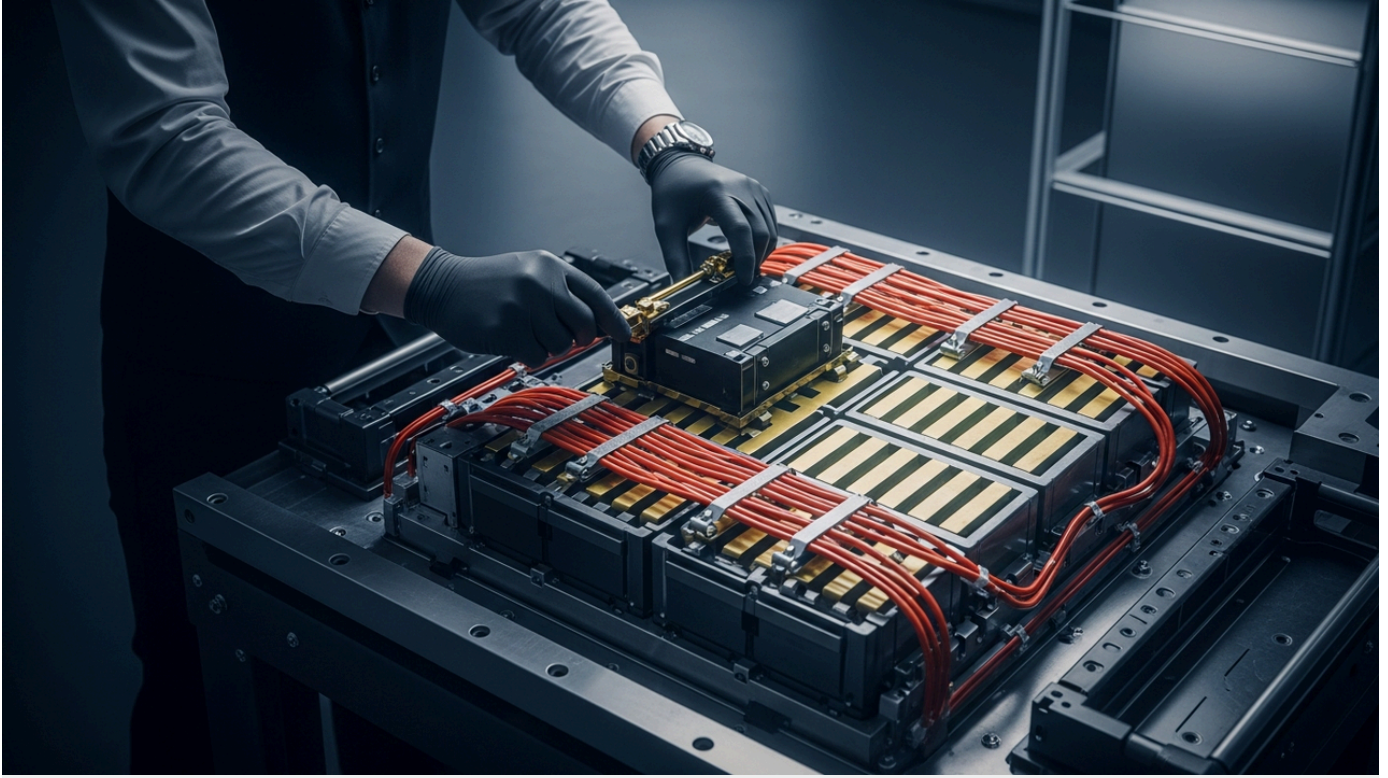
Kizen® Miles 9.0の受賞は、接着剤メーカーが環境イノベーションを推進する大きな動機となります。今後、同様のリサイクル可能かつバイオベースの接着剤が、衛生製品以外の様々な使い捨て製品分野にも拡大していくことが予想されます。Bostikは、この技術を基盤として、さらに多様な持続可能なソリューションを提供し、循環型経済の実現に貢献していく方針です。この動きは、素材サプライヤーから最終製品メーカーに至るまで、サプライチェーン全体でのサステナビリティ変革を加速させるでしょう。

元記事: <https://www.adhesivesmag.com/articles/102469-bostik-honored-for-breakthrough-recyclable-hygiene-adhesive>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

米熱界面材料市場、2033年までにEVバッテリーパックの熱ギャップフィラー需要で大幅成長

公開日 2026年06月18日 Marks Park Solutions アメリカ



概要

本記事はMarks Park Solutionsが発行した市場調査レポートの概要紹介です。米国の熱界面材料（TIM）市場は、電気自動車（EV）バッテリーパックにおける熱ギャップフィラーの採用増加に強く牽引され、2033年までに大きく成長すると予測されています。この成長は、バッテリーの安全性、熱均一性、および充電性能の向上への要求に支えられています。主要企業はEV生産拡大に対応するため、ギャップフィラーの生産能力を強化しており、100 kWhのLi-ionバッテリーパックあたり1.5~4kgのギャップフィラーが必要とされています。

詳細

主要成果

本記事はMarks Park Solutionsが発行した市場調査レポートの概要紹介です。米国の熱界面材料（TIM）市場は、電気自動車（EV）バッテリーパックにおける熱ギャップフィラーの採用増加により、2033年までに大幅な成長が見込まれています。この傾向は、EVバッテリーの安全性、熱均一性、充電性能を向上させるという自動車業界の継続的な努力によって加速されています。

レポート概要

本レポートは、米国の熱界面材料市場に焦点を当て、特にEVバッテリーパックの熱管理ソリューションとしてのギャップフィラーに注目しています。市場規模、シェア、成長予測、主要な推進要因、および地域別の分析が含まれています。調査期間は現在から2033年までを対象としています。

主要な調査結果

- **EVバッテリーパックの需要:** 米国のTIM市場は、EVバッテリーパックにおける熱ギャップフィラーの需要急増によって強かに推進されています。これは、バッテリーの過熱を防ぎ、安全性を確保し、最適な動作温度を維持することでバッテリー寿命を延ばすために不可欠です。
- **ギャップフィラーの消費量:** 報告によると、容量100 kWhのLi-ionバッテリーパックあたり、平均して1.5kgから4kgの熱ギャップフィラーが必要とされています。EV生産の拡大に伴い、この需要は飛躍的に増加すると予測されています。
- **主要企業の生産能力増強:** Henkel、Parker Hannifin、FujipolyといったTIMの主要メーカーは、EV産業からの高まる需要に応えるため、熱ギャップフィラーの生産能力を積極的に増強しています。これは、市場の成長機会を捉えるための戦略的な動きです。

発行会社について

Marks Park Solutionsは、幅広い産業分野における市場調査レポートを提供するグローバルな調査会社です。同社は、詳細な市場分析、競争環境評価、将来予測を通じて、クライアントが戦略的な意思決定を行うための知見を提供しています。

元記事: <https://marksparksolutions.com/reports/us-thermal-interface-materials-market>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

レゾナック、生成AI向け2.5D半導体液状封止材の特許有効性を日本特許庁が維持

公開日 2026年06月17日 IBTimes JP 日本



概要

レゾナックは、生成AI用2.5D半導体パッケージに不可欠な液状封止材に関する同社の特許（特許番号7687499）が、日本特許庁によって有効と判断されたことを発表しました。この特許維持は、高密度AIチップパッケージで発生する熱膨張差に起因する応力や亀裂問題を効果的に解決する同社技術の重要性を裏付けるものです。これにより、AI半導体の信頼性向上と高性能化に大きく貢献するレゾナックの市場競争力が強化されます。

詳細

主要成果

レゾナックは、生成AI向け2.5D半導体パッケージ用液状封止材に関する特許（特許番号7687499）の有効性が、日本特許庁によって維持されたことを発表しました。この決定は、高密度半導体パッケージにおける熱膨張差による信頼性問題を解決するレゾナックの独自技術が、引き続き市場で保護されることを意味します。

技術・臨床詳細

- **2.5D半導体パッケージング技術:** 2.5Dパッケージは、複数の半導体チップ（例えば、ロジックとHBM）をシリコンインターポーザー上に並列に配置し、高密度な統合を実現する先端技術です。これにより、データ伝送速度の向上と電力効率の改善が可能となります。
- **液状封止材の役割:** 2.5Dパッケージでは、異なる素材間の熱膨張率の差により、温度変化時に大きな応力が発生し、チップや配線の亀裂、剥離といった信頼性問題を引き起こすリスクがあります。レゾナックの液状封止材は、この熱応力を緩和し、パッケージ全体の耐久性と信頼性を大幅に向上させることを目的としています。
- **特許番号7687499:** この特許は、特定の化学組成と構造を持つ液状封止材に焦点を当てており、特に高アスペクト比のギャップ充填能力と、硬化後の低応力特性を特徴としています。これにより、繊細な2.5Dパッケージの長期信頼性を保証します。

背景・業界文脈

生成AIの爆発的な普及により、高性能AIチップの需要がかつてないほど高まっています。これらのAIチップは、膨大なデータを高速で処理するために、先進的なパッケージング技術、特に2.5Dおよび3D積層技術を必要とします。このような高密度パッケージングでは、材料の信頼性が極めて重要であり、液状封止材のような基盤材料の性能が、最終製品の安定性と寿命を左右します。レゾナックは、長年にわたる材料技術の専門知識を活かし、この分野でリーダーシップを確立しています。

今後の展望

日本特許庁による特許有効性の維持は、レゾナックがAI半導体市場において、その技術的優位性を確保し続けるための重要なステップです。これにより、同社は競合他社に対する明確な差別化を維持し、生成AIおよび高性能コンピューティング分野でのサプライチェーンにおいて、その影響力をさらに拡大するでしょう。今後も、より高性能で信頼性の高い半導体パッケージング材料の開発競争が激化する中で、レゾナックの技術は業界の進化を牽引する中核となることが期待されます。

元記事: <https://jp.ibtimes.com/resonac-wins-japan-patent-ruling-25d-ai-chip-material-101701>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

3M VHB 4920アクリルフォームテープ、AIサーバーやEV向け高強度接合ソリューションを提案

公開日 2026年06月11日 Yousan New Materials アメリカ



概要

3Mは、機械的締結具に代わる高強度で目に見えない接着を提供する両面アクリルフォームテープ「3M VHB 4920」を発表しました。このテープは、AIサーバー、光通信機器、輸送システム、電子ディスプレイ、産業機器、看板など多岐にわたる用途で、優れた環境耐性、振動吸収性、長期耐久性を発揮します。特に、接着強度の高さと多様な材料への適用性が、設計の自由度と製造効率の向上に貢献します。

詳細

主要成果

3Mは、従来の機械的締結具の代替として、高強度かつ目に見えない接着を実現する両面アクリルフォームテープ「3M VHB 4920」を市場に投入しました。この革新的な製品は、AIサーバー、光通信機器、輸送システム、電子ディスプレイ、産業機器、看板といった多様な分野で、卓越した環境耐性、振動吸収性、そして長期にわたる耐久性を提供し、幅広い接着ソリューションを可能にします。

技術・臨床詳細

- **高強度接着:** 3M VHB 4920は、独自の粘弾性アクリルフォームコアにより、金属、ガラス、プラスチック、複合材など、さまざまな基材に対して強力かつ永続的な接着を実現します。これにより、応力集中を最小限に抑えつつ、高いせん断強度と剥離強度を提供します。
- **振動吸収と疲労耐性:** フォーム構造が振動と衝撃を効果的に吸収し、疲労応力に対する耐性を高めます。これは、輸送機器や産業機械など、動的な負荷がかかる環境での機器の信頼性と寿命向上に貢献します。
- **環境耐性:** 厳しい温度変化、紫外線、湿気、化学薬品などに対し、優れた耐性を示します。屋内および屋外の過酷な環境下でも、長期にわたって接着性能を維持できるため、幅広いアプリケーションでの使用が可能です。
- **多様なアプリケーション:** 特に、AIサーバーや光通信機器の精密な部品固定、EVを含む輸送機器の構造接着、電子ディスプレイの組み立て、耐久性が求められる産業機器の固定、屋外設置される看板の取り付けなど、高性能が求められる分野でその真価を発揮します。

背景・業界文脈

今日の製造業では、製品の軽量化、デザインの自由度向上、生産プロセスの簡素化が求められています。従来の溶接やリベット、ネジといった機械的締結具は、重量増加、応力集中、外観への影響、異種材料接合の難しさといった課題を抱えていました。3M VHBテープは、これらの課題に対するクリーンで効率的、かつ高性能な代替ソリューションとして、数十年にわたり進化を続けてきました。特に、AIやEVといった新興技術分野では、熱管理や振動対策が重要となるため、高性能接着テープの需要が高まっています。

今後の展望

3M VHB 4920のような高性能アクリルフォームテープは、今後も電子機器、自動車、航空宇宙、建設といった多岐にわたる産業でその応用範囲を拡大していくと予想されます。特に、小型化、高効率化、耐久性向上が進む中で、目に見えない強固な接着技術は不可欠な要素となります。3Mは、材料科学の専門知識を活かし、さらなる性能向上、環境負荷低減、および特定用途に特化したカスタマイズ製品の開発を進めることで、高機能接着ソリューション市場におけるリーダーシップを強化していくでしょう。

元記事: <https://www.ysdiecut.com/3m-vhb-4920-acrylic-foam-tape-high-strength-bonding-solution-for-electronics-transportation-industrial-applications/>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

レゾナックCEO、AIチップ需要急増と中国サプライチェーンリスクを両立させる戦略を強調

公開日 2026年06月18日 Crypto Briefing 日本



概要

高帯域幅メモリ（HBM）チップ用非導電性フィルムおよび2.5D半導体パッケージ用液状封止材の主要サプライヤーであるレゾナック・ホールディングスのCEOは、AIチップの急増する需要に対応しつつ、中国サプライチェーンのリスクを戦略的に管理する方針を強調しました。最近の日本特許庁による液状封止材に関する同社特許の有効性維持は、レゾナックの市場での技術的地位をさらに強固にするものです。これにより、同社はグローバルな半導体エコシステムにおける競争力を高め、AI革命を支える基盤材料の安定供給に貢献します。

詳細

主要成果

レゾナック・ホールディングスのCEOは、高帯域幅メモリ（HBM）チップ用非導電性フィルム（NCF）や2.5D半導体パッケージ用液状封止材といった主要材料のサプライヤーとして、爆発的に増加するAIチップ需要に対応しながら、同時に中国サプライチェーンに関連する地政学的リスクを巧みに乗り越える戦略を示しました。最近の日本特許庁による液状封止材に関する特許有効性の維持は、同社の技術的優位性を強化する重要な要素となっています。

技術・臨床詳細

- **AIチップ向け先端材料:** レゾナックは、特にHBMチップと2.5Dパッケージングに不可欠な二つの主要材料を提供しています。HBMは、従来のDRAMと比較して圧倒的なデータ帯域幅を提供し、AIプロセッサの性能を最大化するために不可欠です。NCFは、HBMチップの積層において電氣的絶縁と機械的保護を提供し、液状封止材は2.5Dパッケージ内の異なるチップ間の熱応力を緩和し、信頼性を高めます。
- **特許技術の重要性:** 日本特許庁が液状封止材に関するレゾナックの特許を維持したことは、同社の独自の配合技術と製造プロセスが市場で保護されることを意味します。この特許技術は、複雑な2.5D半導体パッケージにおける熱膨張差によって生じる応力集中や亀裂発生を防ぎ、製品の長期信頼性を確保する上で決定的な役割を果たします。
- **中国サプライチェーンリスク管理:** 半導体産業における中国依存度の高まりは、サプライチェーンの安定性に関する懸念を引き起こしています。レゾナックは、生産拠点の多角化や代替材料調達ルートの確立を通じて、これらのリスクを軽減し、グローバル市場への安定供給体制を構築しています。

背景・業界文脈

生成AIの急速な進化は、高性能半導体、特にHBMを搭載したGPUの需要を空前のレベルに押し上げています。しかし、半導体製造サプライチェーンは、地政学的緊張や供給網の脆弱性といったリスクに常に晒されています。レゾナックのような主要材料サプライヤーは、技術革新を続ける一方で、これらのリスクを管理し、安定供給を確保する責任を負っています。日本の材料メーカーは、長年にわたり培ってきた高精度な技術力と品質管理能力により、世界の半導体産業を支える重要な役割を担っています。

今後の展望

レゾナックのCEOが示す戦略は、AI時代における半導体材料サプライヤーの模範となり得ます。技術的優位性の維持とサプライチェーンのレジリエンス強化は、今後の企業成長の鍵となります。特許権の保護は、同社が研究開発に継続的に投資し、次世代のAI半導体に必要なさらなる革新的な材料ソリューションを提供するための基盤を固めます。これにより、レゾナックはAI革命の中心で、その影響力を一層拡大していくことが期待されます。

元記事: <https://cryptobriefing.com/resonac-ceo-ai-demand-china-risks/>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#16 H.B. Fuller、2030年までの持続可能性目標と革新への注力：新航空宇宙センター開設も

公開日 2026年06月15日 Business Wire アメリカ



概要

H.B. Fullerは、2030年までの新たな持続可能性目標を掲げた2025年持続可能性レポートを発表し、新製品開発のほぼ60%を持続可能なソリューションに集中させる方針を明らかにしました。同社は環境目標をビジネス戦略、製品革新、グローバル事業に統合し、航空宇宙・防衛市場での成長を加速させるため、新しい航空宇宙製造センター・オブ・エクセレンスを開設しました。この取り組みは、顧客の持続可能性プロフィール向上とイノベーションへのコミットメントを強調するものです。

詳細

主要成果

H.B. Fullerは、2030年までの野心的な持続可能性目標を設定した2025年持続可能性レポートを発表し、新製品開発の約60%を持続可能なソリューションに特化させることを明らかにしました。同社は、環境目標を企業のビジネス戦略、製品革新、およびグローバル事業運営に深く統合しています。この取り組みの一環として、航空、宇宙、防衛市場での成長を加速させるため、新しい航空宇宙製造センター・オブ・エクセレンスも開設しました。

技術・臨床詳細

- **2030年持続可能性目標:** H.B. Fullerは、温室効果ガス排出量、水使用量、廃棄物発生量の削減、再生可能エネルギーの利用拡大など、具体的な環境パフォーマンス目標を掲げています。これらの目標は、製品のライフサイクル全体での環境負荷を低減することを目指しており、科学的根拠に基づく目標（SBT）に沿ったものです。
- **持続可能な製品革新:** 新製品開発のほぼ60%が、顧客製品の持続可能性プロファイル（例: 再生可能含有量、リサイクル性、耐久性、低VOC）を向上させる接着剤およびシーラントに重点を置いています。これにより、顧客が自社の環境目標を達成できるよう支援します。例としては、バイオベースの原料を使用した接着剤や、製品の耐久性を高めて長寿命化に貢献するソリューションなどが挙げられます。
- **航空宇宙製造センター・オブ・エクセレンス:** 新たに開設されたセンターは、航空宇宙および防衛産業に特化した高性能接着ソリューションの研究開発、試験、製造を加速させます。この分野では、極端な環境条件下での高い信頼性と軽量化が求められるため、持続可能性と高性能を両立させる革新的な接着剤が不可欠です。

背景・業界文脈

世界的に、企業は環境・社会・ガバナンス（ESG）の側面に対する投資家、顧客、規制当局からの圧力に直面しています。接着剤業界も例外ではなく、持続可能な材料、製造プロセス、および製品の提供が競争優位性となります。H.B. Fullerのようなグローバルリーダーは、これらの要求に応えることで、市場での地位を強化し、長期的な成長を確保しようとしています。特に航空宇宙産業は、軽量化と排出量削減の推進において接着剤技術に大きく依存しており、持続可能なソリューションへの需要が高まっています。

今後の展望

H.B. Fullerの包括的な持続可能性戦略と、それに伴う製品革新への大規模な投資は、接着剤業界における新たなトレンドを形成するでしょう。特に、高性能かつ環境に配慮した接着剤の供給は、自動車、電子機器、建設、包装など、広範な産業でのサステナビリティ目標達成に不可欠となります。新しい航空宇宙センターは、特定の高付加価値市場での同社の専門知識と市場シェアを拡大し、未来の航空機や宇宙船の設計・製造において中心的な役割を果たすことが期待されます。これにより、H.B. Fullerは、環境責任と経済的成功を両立させる企業としての地位を確立するでしょう。

元記事: https://www.businesswire.com/news/home/20260615010269/en/H.B.-Fuller-Sets-2030-Sustainability-Targets-With-Nearly-60-of-Innovation-Focused-on-Sustainable-Solutions?feedref=JjAwJuNHystnCoBq_hl-b8mHqlca79f9L_1D8FBjKy3YTodZHb7dXSPOSeFM4p9pjDYS2ugett3oMAQIYJVXY_0dKdFRTEhrF3avD2KCHBRGE

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#17 Advanced Medical Solutions、H.B. Fullerからの買収 提案交渉期限を2026年7月2日まで延長

公開日 2026年06月18日 LSE.co.uk イギリス



概要

Advanced Medical Solutions Group PLCは、H.B. Fuller Co.からの買収提案に関する協議期間を延長することを発表しました。新たな「Put-up-or-shut-up」期限は2026年7月2日に設定され、両接着剤メーカー間の交渉が継続中であることを示しています。この延長は、合併・買収交渉における一般的な手順であり、両社の戦略的提携の可能性について市場の注目を集めています。

詳細

主要成果

Advanced Medical Solutions Group PLC (AMS) は、H.B. Fuller Co.からの買収提案に関する公式な交渉期限を2026年7月2日まで延長したことを発表しました。この「Put-up-or-shut-up」期限の延長は、両接着剤メーカー間で戦略的対話が引き続き行われていることを示唆しており、市場は今後の動向を注視しています。

技術・臨床詳細

- **買収提案の背景:** H.B. Fullerは、接着剤、シーラント、その他特殊化学品の世界的リーダーであり、医療分野にも強い関心を示しています。一方、Advanced Medical Solutionsは、創傷ケアおよび組織接着剤分野に特化した製品を持つ企業です。この買収が実現すれば、H.B. Fullerは医療分野におけるポートフォリオを強化し、AMSはより広範な販売網と研究開発リソースを活用できる可能性があります。
- **「Put-up-or-shut-up」期限:** これは英国の公開買付け規則 (Takeover Code) における規定で、提案された買収側が特定の期日までに正式な買収意図を表明するか、または買収提案を撤回しなければならないというものです。今回の延長は、両社が詳細なデューデリジェンスや条件交渉に時間を要していることを示唆しています。
- **市場への影響:** 医療用接着剤市場は、高齢化社会の進展や医療技術の高度化に伴い、着実に成長しています。この分野における大手企業間の統合は、製品ラインナップの多様化、技術革新の加速、市場シェアの再編といった形で業界に大きな影響を与える可能性があります。

背景・業界文脈

接着剤業界全体では、企業の統合・再編が活発化しており、特に高成長が見込まれる医療や電子機器などの専門分野への投資が加速しています。H.B. Fullerは、成長戦略の一環としてM&Aを積極的に活用しており、特定の市場セグメントにおけるリーダーシップを確立することを目指しています。Advanced Medical Solutionsのようなニッチな専門企業は、その技術力と市場アクセスが大手企業にとって魅力的であるため、買収ターゲットとなることが多いです。

今後の展望

2026年7月2日までの新たな期限は、H.B. FullerがAdvanced Medical Solutionsに対し、拘束力のある買収提案を行うか否かを決定する重要な節目となります。買収が成立した場合、医療用接着剤市場における両社の技術と市場の統合により、新たな製品開発や市場浸透が期待されます。一方、交渉が決裂した場合は、AMSが独立した成長戦略を追求するか、あるいは他の潜在的買収者を探す可能性があります。いずれにせよ、この動向は医療用接着剤および特殊化学品業界の競争環境に影響を与えるでしょう。

元記事: <https://www.lse.co.uk/news/in-brief-advanced-medical-solutions-extends-hb-fuller-offer-deadline-2tiopf7xr0mgji6.html>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#18 3M、原子レベルの材料解析を可能にする新走査型透過電子顕微鏡を導入し製品開発を加速

公開日 2026年06月18日 3M Newsroom アメリカ

3M

概要

3Mは、材料を原子レベルで詳細に解析できる世界クラスの最新走査型透過電子顕微鏡（STEM）を導入しました。この高度な分析能力は、接着剤や先進材料を含む幅広い3M製品の構造と性能の関係を直接観察することを可能にし、製品開発サイクルを大幅に加速させます。これにより、より迅速な新素材の創出と既存製品の製造プロセスの改善が期待され、技術革新を一層推進する基盤が構築されます。

詳細

主要成果

3Mは、同社の研究開発能力を飛躍的に向上させるため、材料を原子レベルで分析可能な世界クラスの最新走査型透過電子顕微鏡（STEM）を導入しました。この高性能顕微鏡は、接着剤や先進材料といった多岐にわたる3M製品の微細構造と巨視的性能との間の直接的な関係を解明することを可能にし、結果として製品開発のサイクルタイムを大幅に短縮します。

技術・臨床詳細

- **原子レベルでの材料解析:** 新しいSTEMは、材料の原子配列、欠陥、異種界面などをナノメートルスケールで詳細に観察する能力を持ちます。これにより、接着剤の分子構造が接着強度や耐久性にどのように影響するか、あるいは複合材料の界面における相互作用が全体の機械的特性にどう影響するかといった根本的なメカニズムを解明することができます。
- **製品開発の加速:** 材料の振る舞いを原子レベルで理解することで、研究者は試行錯誤のプロセスを減らし、よりの確な材料設計と最適化を行うことが可能になります。これは、新世代接着剤の配合開発、薄膜材料の特性改善、あるいはナンスケール構造を持つ機能性材料の創出において、ブレークスルーを加速させるでしょう。
- **製造プロセスの改善:** 材料科学的洞察は、既存製品の製造プロセスを精密に調整し、品質と効率を向上させることにも直結します。例えば、硬化プロセスの最適化、欠陥発生メカニズムの特定、または材料の均一性向上などが挙げられます。

背景・業界文脈

材料科学の分野では、原子レベルでの構造制御が製品の性能を決定する上でますます重要になっています。特に、高性能接着剤、光学材料、バッテリー材料、電子部品など、3Mが事業を展開する多くの分野では、ナノスケールの精密な材料設計が不可欠です。最先端の顕微鏡技術への投資は、企業が競争優位性を維持し、次世代技術の要求に応えるための重要な戦略です。

今後の展望

この世界クラスのSTEMの導入は、3Mが革新的な材料ソリューションの創出において、そのリーダーシップをさらに強化する兆候です。原子レベルでの詳細な理解は、接着技術のブレークスルーを可能にし、より軽量で、より耐久性があり、より高性能な製品を開発する上で不可欠です。例えば、EVバッテリーの熱管理、航空宇宙部品の軽量化、医療機器の生体適合性向上など、未来の技術課題に対する3Mの対応能力を大幅に高めるでしょう。この投資は、長期的な競争力と市場への価値提供を保証するものです。

元記事: <https://news.3m.com/3M-brings-atomic-scale-innovation-into-focus-with-new-microscope>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#19 味の素、AI需要急増下のABF価格据え置き戦略で投資家のポートフォリオ再構築を問う

公開日 2026年06月14日 Simply Wall St News 日本



概要

記録的な決算とAI関連のABF（味の素ビルドアップフィルム）に対する強い需要にもかかわらず、味の素株式会社はABFの価格を維持し、2032年までの生産能力拡張を計画しています。この戦略は、半導体材料における支配的な市場地位を活用しつつ、顧客との長期的な関係を維持することを目的としており、投資家からの価格引き上げ圧力とは対照的なアプローチです。この動きは、味の素の企業価値と将来的な成長への投資家の見方に影響を与える可能性があります。

詳細

主要成果

味の素株式会社は、AI関連のABF（味の素ビルドアップフィルム）に対する需要が急増し、記録的な好決算を達成しているにもかかわらず、ABFの販売価格を据え置く方針を維持しています。同時に、同社は2032年までの長期的な生産能力拡張計画を推進しています。この戦略は、半導体材料市場における支配的な地位を利用して短期的な利益を追求するのではなく、顧客との強固な関係を構築し、長期的な市場成長に貢献することを目指すものであり、一部の投資家が期待する価格引き上げとは一線を画しています。

技術・臨床詳細

- **ABFの市場支配力:** 味の素は、先端半導体パッケージングに不可欠な絶縁材料であるABFにおいて、世界市場で圧倒的なシェアを占めています。ABFは、CPU、GPU、AIアクセラレータなどの高性能チップの多層基板製造に不可欠であり、その高い誘電特性、薄型化、優れた熱安定性が評価されています。
- **価格据え置き意図:** AIチップ需要の急増は、ABFのような重要材料の供給不足を引き起こす可能性があり、通常であれば価格上昇の要因となります。しかし、味の素は、顧客が予見可能なコストで安定した材料供給を受けられるようにすることで、長期的なパートナーシップとエコシステム全体の成長を支援する戦略を選択しました。これは、短期的な収益最大化よりも、長期的な企業価値向上を重視するものです。
- **生産能力拡張のコミットメント:** 2032年までを見据えた生産能力拡張は、味の素が将来のAIおよび高性能コンピューティング市場の成長を確信していることを示しています。この投資は、技術革新を支え、半導体メーカーが次世代チップの開発を安心して進められる環境を提供します。

背景・業界文脈

AI革命は、半導体産業に前例のない需要をもたらしており、特に高性能プロセッサとそれを支える先進パッケージング技術の重要性が増しています。ABFは、このような先端パッケージの性能を左右する基幹材料の一つであり、その安定供給はグローバルな半導体サプライチェーンにとって極めて重要です。味の素の戦略は、単なる材料サプライヤーに留まらず、半導体エコシステム全体の安定と成長に貢献するという、より広範な視点に基づいています。

今後の展望

味の素の価格据え置きと大規模な生産能力拡張計画は、同社の長期的な戦略的ビジョンを示しています。これは、投資家に対して、短期的な利益変動だけでなく、長期的な成長と市場での持続的なリーダーシップに焦点を当てるよう促すものです。このアプローチは、半導体産業のサプライチェーンに安定性をもたらし、次世代AI技術の革新と商業化を支援する重要な要素となるでしょう。味の素は、この戦略を通じて、材料分野における「隠れた巨人」としての地位をさらに盤石にする可能性があります。

元記事: <https://simplywall.st/stocks/jp/food-beverage-tobacco/tse-2802/ajinomoto-shares/news/does-holding-abf-prices-amid-ai-demand-recast-ajinomotos-por>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#20 AI需要拡大で味の素ABFが供給逼迫の試練に直面、価格戦略が焦点に

公開日 2026年06月17日 digitimes 台湾



概要

AIチップの世界的な需要急増が、先端半導体パッケージングの主要材料である味の素ビルドアップフィルム（ABF）の供給に新たな圧力をかけています。これにより、味の素はABFの価格引き上げ圧力に直面しており、その価格戦略が業界の注目を集めています。この状況は、味の素が供給能力のバランスを取りながら、急激な需要増に対応するための重要な局面にあることを示唆しています。

詳細

主要成果

AIチップの世界的な需要が急激に増加する中、先端半導体パッケージングの不可欠な材料である味の素ビルドアップフィルム（ABF）が供給逼迫の試練に直面しています。この状況は、ABFの主要サプライヤーである味の素に対し、価格引き上げの可能性を巡る圧力を高めており、同社の今後の価格戦略が半導体業界全体の注目を集めています。

技術・臨床詳細

- **ABFの重要性と需要:** ABFは、高性能CPU、GPU、AIアクセラレータなどの多層ICパッケージ基板に使用される絶縁フィルムです。その高い誘電特性と熱安定性、薄型化能力により、AIチップの性能向上と小型化に不可欠な役割を果たしています。AIの進化に伴い、HBM（高帯域幅メモリ）を搭載したチップレットパッケージや2.5D/3D積層技術の採用が加速しており、ABFの需要はかつてないほど高まっています。
- **供給逼迫の背景:** 味の素は長年にわたりABF市場をほぼ独占してきましたが、AI需要の急増は、既存の生産能力が急速に追いつかなくなる可能性を浮上させています。半導体製造プロセスは非常に複雑で、材料供給がボトルネックとなることが多く、ABFもその例外ではありません。
- **価格引き上げの圧力:** 需要が供給を上回る状況は、通常、価格の上昇につながります。半導体メーカーは、安定した材料供給を確保するため、価格プレミアムを支払うことを厭わない傾向にあります。味の素は、このような市場環境下で、長期的な顧客関係と短期的な収益機会の間でバランスを取るという難しい判断を迫られています。

背景・業界文脈

半導体産業は、地政学的リスク、パンデミック、技術革新の加速など、複数の要因によって常に変動しています。特にAI分野の台頭は、サプライチェーン全体に新たな圧力をかけており、材料メーカーの供給能力と価格設定が、最終製品のコストと市場投入時期に直接影響を与えます。味の素のABFは、その性能と市場シェアの大きさから、半導体業界における「隠れた要石」と見なされており、その動向は業界全体に波及効果をもたらします。

今後の展望

味の素のABFに対する価格引き上げの可能性に関する議論は、同社が今後どのような戦略的決定を下すかに注目が集まっています。生産能力のさらなる大規模な拡張、または価格改定を通じた需要調整のいずれを選択するにしても、その決定はAIチップの将来的な供給とコスト構造に大きな影響を与えるでしょう。この状況は、半導体材料サプライヤーが直面する課題と、高度な技術的優位性を維持しつつ、変動する市場ニーズにどのように対応していくかを示す重要な事例となります。

元記事: <https://www.digitimes.com/news/a20260616VL220/demand-chips-materials.html>

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#21 PU接着剤市場、自動車エレクトロニクス小型化と熱管理の進化で拡大：3M、Henkel、Dowが主導

公開日 2026年06月18日 openPR.com 国際



概要

本記事はopenPR.comが紹介する市場調査レポートの概要です。ポリウレタン（PU）接着剤は、コンポーネントの組み立て、回路の固定、敏感な部品の封止、構造的完全性の向上など、電子機器製造において不可欠な接着材料としてその地位を確立しています。3M、Henkel、Dow、Panacol-Elosol、DELO、Nitto Denkoなどの主要企業は、小型化された柔軟な自動車用電子機器向けに、優れた接着性、振動減衰、熱管理性能を持つ配合を革新しており、市場拡大の主要な牽引役となっています。

詳細

主要成果

本記事はopenPR.comが紹介する市場調査レポートの概要です。ポリウレタン（PU）接着剤は、電子機器製造の根幹を支える不可欠な接着材料としての役割を強化しており、特にコンポーネントの組み立て、回路の固定、敏感な部品の封止、および構造的完全性の向上に貢献しています。市場は、3M、Henkel、Dowといったグローバルリーダーによって牽引されており、これらの企業は小型化と柔軟性が求められる自動車用電子機器向けに、卓越した接着性、振動減衰能力、および高度な熱管理性能を持つ新たなPU接着剤を開発しています。

レポート概要

このレポートは、電子機器市場におけるポリウレタン（PU）接着剤の主要な推進要因、市場規模、技術動向、および主要企業戦略を分析しています。特に、自動車用電子機器の進化がPU接着剤市場に与える影響に焦点を当て、2026年以降の市場拡大を予測しています。

主要な調査結果

- **電子機器製造におけるPU接着剤の汎用性:** PU接着剤は、その優れた接着強度、柔軟性、耐熱性、電気絶縁性により、様々な電子部品の固定と保護に使用されます。PCB（プリント基板）への部品接着、ディスプレイパネルの組み立て、センサーの封止、ケーブル固定など、幅広いアプリケーションでその価値を発揮します。
- **自動車用電子機器の小型化と要求増大:** 電気自動車（EV）やADAS（先進運転支援システム）の普及に伴い、自動車内の電子制御ユニット（ECU）やセンサーは、より小型で高密度、かつ過酷な環境に耐えることが求められています。PU接着剤は、これらの機器の振動、熱、湿気からの保護に貢献し、長期的な信頼性を確保します。
- **熱管理と振動減衰機能の強化:** 最新のPU接着剤は、熱伝導性フィラーの配合により、優れた熱管理能力を持つものが登場しています。これにより、発熱量の高い電子部品の効率的な冷却が可能になります。また、PUの粘弾性特性は、車両の振動を効果的に減衰させ、電子部品への機械的ストレスを軽減します。

- **主要企業のイノベーション:** 3M、Henkel、Dow、Panacol-Elosol、DELO、Nitto Denkoなどの業界リーダーは、市場ニーズに応えるため、カスタム配合された高性能PU接着剤を継続的に開発しています。これには、迅速な硬化時間、低応力、環境適合性の改善などが含まれます。

発行会社について

openPR.comは、企業がニュースリリースを配信し、幅広いメディアやオンラインプラットフォームに情報を発信するプレスリリース配信サービスです。同社は、市場レポートの概要やビジネスニュースを広範な読者に提供することを支援しています。

元記事: [https://tudomuaban.com/chi-tiet-rao-vat/2940768/polyurethane-\(pu\)-adhesives-in-electronics-market-key-drivers-shaping-industry-expansion.html](https://tudomuaban.com/chi-tiet-rao-vat/2940768/polyurethane-(pu)-adhesives-in-electronics-market-key-drivers-shaping-industry-expansion.html)

収集日: 2026年06月19日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)